




# OptiPlex 5080 소형 폼 팩터 서비스 설명서

고지 사항: 이 콘텐츠는 AI(Artificial Intelligence)를 사용하여 번역되었습니다. 번역된 내용은 오류를 포함할 수 있으며 어떠한 유형의 보증도 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. 번역되지 않은 원본을 확인하려면 영어 버전을 참조해 주십시오. 이 콘텐츠에 대한 질문이나 우려 사항이 있는 경우 Dell에 이메일 ([Dell.Translation.Feedback@dell.com](mailto:Dell.Translation.Feedback@dell.com))로 문의해 주시기 바랍니다.

## 참고, 주의 및 경고

 **노트:** 참고는 제품을 보다 효과적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요한 정보를 나타냅니다.

 **주의:** 주의는 잠재적 하드웨어 손상이나 데이터 손실을 나타내며, 문제를 방지하는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** 경고는 재산 피해, 개인 상해 또는 사망의 위험이 있음을 나타냅니다.

<b>장 1: 컴퓨터에서 작업하기</b> .....	<b>5</b>
안전 지침.....	5
컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에.....	5
안전 지침.....	6
정전기 방전 - ESD 방지.....	6
ESD 현장 서비스 키트.....	7
컴퓨터 내부 작업을 마친 후에.....	7
<b>장 2: 기술 및 구성 요소</b> .....	<b>9</b>
그래픽 옵션.....	9
인텔 UHD 610 그래픽.....	9
인텔 UHD 630 그래픽.....	9
NVIDIA GeForce GT 730.....	10
AMD Radeon RX 640.....	11
AMD Radeon R5 430.....	12
시스템 관리 기능.....	12
<b>인밴드(In-Band) 시스템 관리용 Dell Client Command Suite</b> .....	13
<b>장 3: 현장 서비스 정보</b> .....	<b>14</b>
측면 덮개.....	14
측면 커버 제거.....	14
측면 커버 설치.....	16
전면 베젤.....	17
전면 베젤 제거.....	17
전면 베젤 설치.....	18
하드 드라이브 어셈블리.....	18
2.5" 하드 드라이브 하드 드라이브 어셈블리.....	18
하드 드라이브 브래킷 분리.....	19
설치: 2.5" 하드 드라이브 어셈블리.....	20
하드 드라이브 브래킷 설치.....	21
솔리드 스테이트 드라이브.....	22
M.2 2230 PCIe 솔리드 스테이트 드라이브 제거.....	22
M.2 2230 PCIe 솔리드 스테이트 드라이브 설치.....	23
M.2 2280 PCIe 솔리드 스테이트 드라이브 제거.....	24
M.2 2280 PCIe 솔리드 스테이트 드라이브 설치.....	25
WLAN 카드.....	26
WLAN 카드 제거.....	26
WLAN 카드 설치.....	27
슬림 옵티컬 드라이브.....	29
슬림 옵티컬 디스크 드라이브 제거.....	29
슬림 옵티컬 디스크 드라이브 설치.....	30
방열판.....	31
방열판 제거.....	31
방열판 설치.....	31

코인 셀 배터리.....	32
코인 셀 배터리 제거.....	32
코인 셀 배터리 설치.....	33
메모리 모듈.....	34
메모리 모듈 제거.....	34
메모리 모듈 설치.....	35
프로세서.....	36
프로세서 설치.....	36
프로세서 제거.....	38
시스템 보드.....	39
시스템 보드 제거.....	39
시스템 보드 설치.....	41
<b>장 4: 문제 해결.....</b>	<b>46</b>
Dell SupportAssist 사전 부팅 시스템 성능 검사 진단.....	46
SupportAssist 사전 부팅 시스템 성능 검사 실행.....	46
진단.....	46
진단 오류 메시지.....	47
시스템 오류 메시지.....	50
Wi-Fi 전원 주기.....	51
<b>장 5: 도움말 보기.....</b>	<b>52</b>
Dell에 문의하기.....	52

# 컴퓨터에서 작업하기

## 주제:

- 안전 지침

## 안전 지침

컴퓨터의 손상을 방지하고 안전하게 작업하기 위해 다음 안전 지침을 따르십시오. 달리 명시되지 않는 한, 본 문서에 포함된 각 절차에서는 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽었음을 전제로 설명합니다.

- ⚠ **경고:** 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 숙지하십시오. 추가 안전 모범 사례는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지([www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance))를 참조하십시오.
- ⚠ **경고:** 컴퓨터 커버 및 패널을 열기 전에 모든 전원에서 컴퓨터를 연결 해제합니다. 컴퓨터 내부에서 작업한 후 컴퓨터를 전기 콘센트에 연결하기 전에 커버, 패널 및 나사를 모두 장착합니다.
- ⚠ **주의:** 컴퓨터의 손상을 방지하려면 작업 표면이 평평하고 건조하고 깨끗한지 확인합니다.
- ⚠ **주의:** 구성 요소 및 카드의 손상을 방지하려면 구성 요소 및 카드의 핀이나 단자를 잡지 말고 모서리를 잡습니다.
- ⚠ **주의:** Dell 기술 지원 팀에서 승인하거나 지시한 경우에만 문제 해결 및 수리 작업을 수행해야 합니다. Dell사에서 공인하지 않은 서비스로 인한 손상에 대해서는 보상하지 않습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침 또는 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)의 지침을 참조하십시오.
- ⚠ **주의:** 컴퓨터 내부의 부품을 만지기 전에 컴퓨터 뒷면 금속처럼 도색되지 않은 금속 표면을 만져 접지하십시오. 작업하는 동안 컴퓨터의 도색되지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져 내부 구성 요소를 손상시킬 수 있는 정전기를 제거하십시오.
- ⚠ **주의:** 케이블을 연결 해제할 때는 케이블을 직접 잡아 당기지 말고 커넥터나 당김 탭을 잡아 당깁니다. 일부 케이블에는 잠금 탭이나 손잡이 나사가 있는 커넥터가 달려 있으므로 이와 같은 종류의 케이블을 분리하기 전에 이러한 탭이나 손잡이 나사를 해제해야 합니다. 케이블을 연결 해제할 때는 커넥터 핀이 구부러지지 않도록 평평하게 정렬합니다. 케이블을 연결할 때는 포트 및 커넥터가 올바른 방향으로 정렬되었는지 확인하십시오.
- ⚠ **주의:** 미디어 카드 리더에서 설치된 카드를 모두 눌러 꺼냅니다.
- 📌 **노트:** 컴퓨터와 특정 구성 요소의 색상은 이 설명서와 다를 수도 있습니다.

## 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에

### 이 작업 정보

- 📌 **노트:** 이 문서의 이미지는 주문한 컴퓨터의 구성에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.

### 단계

1. 열려 있는 파일을 모두 저장하고 닫은 다음 사용 중인 응용 프로그램을 모두 종료합니다.
2. 컴퓨터를 종료하십시오. **Start > Power > Shut down**을 클릭합니다.
  - 📌 **노트:** 다른 운영 체제를 사용하고 있는 경우 해당 운영 체제의 설명서에서 종료 지침을 참조하십시오.
3. 컴퓨터 및 모든 연결된 디바이스를 전원 콘센트에서 연결 해제하십시오.
4. 키보드, 마우스, 모니터 등과 같은 연결된 모든 네트워크 디바이스 및 주변 장치를 컴퓨터에서 연결 해제합니다.

**주의:** 네트워크 케이블을 분리하려면 먼저 컴퓨터에서 케이블을 분리한 다음 네트워크 디바이스에서 케이블을 연결 해제합니다.

5. 해당하는 경우, 모든 미디어 카드 및 광학 디스크를 컴퓨터에서 분리합니다.

## 안전 지침

안전 지침 장에서는 분해 지침을 수행하기 전에 따라야 하는 기본 단계를 자세히 설명합니다.

설치를 진행하거나 분해 또는 재조립 단계를 거치는 고장 수리 절차를 진행하기 전에 다음 안전 지침을 준수하십시오.

- 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끕니다.
- 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 AC 전원에서 분리합니다.
- 모든 네트워크 케이블, 전화기 및 통신선을 시스템에서 분리합니다.
- 내부에서 작업할 때는 ESD 현장 서비스 키트를 사용하여 ESD(Electrostatic Discharge)를 방지해야 합니다.
- 시스템 구성 요소를 분리한 후에는 분리된 구성 요소를 정전기 방지 처리된 매트에 조심스럽게 둡니다.
- 비전도성 고무 밑창이 달린 신발을 신어서 감전 사고를 당할 가능성을 줄입니다.

## 대기 전력

대기 전력이 있는 Dell 제품은 케이스를 열기 전에 플러그를 뽑아야 합니다. 대기 전력이 있는 시스템은 기본적으로 시스템을 꺼도 전력이 공급됩니다. 내부 전원을 사용하면 시스템을 원격으로 켜고(LAN을 통해 재개) 절전 모드로 둘 수 있습니다. 다른 고급 전원 관리 기능도 있습니다.

플러그를 뽑고 전원 버튼을 15초 동안 누르고 있으면 시스템 보드에서 잔여 전력이 방전됩니다.

## 결합

결합은 2개 이상의 접지 전도체를 동일한 전위에 연결하는 방법으로, 현장 서비스 정전기 방전(ESD) 키트를 사용하여 수행합니다. 결합 와이어를 연결할 때는 베어 메탈에 와이어를 연결해야 하며, 페인트를 칠한 표면이나 비금속 표면에 와이어를 연결해서는 안 됩니다. 또한 손목 스트랩을 피부에 잘 고정하고 본인과 장비를 결합하기 전에 시계, 팔찌 또는 반지와 같은 모든 장신구를 빼야 합니다.

## 정전기 방전 - ESD 방지

ESD는 확장 카드, 프로세서, 메모리 DIMM, 시스템 보드와 같이 민감한 전자 구성 요소를 다룰 때 아주 중요한 부분입니다. 너무 짧은 시간으로 충전할 경우 간헐적인 문제 또는 제품 수명 단축 등 원인 불명으로 회로가 손상될 수 있습니다. 업계에서 전력 요구 사항의 완화와 집적도 향상을 요구함에 따라 ESD 보호에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

최근 Dell 제품에 사용된 반도체의 집적도 향상으로 인해 정전기로 인한 손상 정도가 이전 Dell 제품에 비해 높아짐에 따라 일부 부품 처리에 승인된 이전 방법이 더 이상 적용되지 않게 되었습니다.

두 가지 대표적인 ESD 손상 유형으로는 치명적인 오류와 간헐적으로 발생하는 오류가 있습니다.

- **치명적인 오류** - 이러한 오류는 ESD 관련 오류의 약 20%를 차지합니다. 장치 기능이 즉각적으로 완전히 손실되는 오류입니다. 정전기 충격을 받은 메모리 DIMM, 메모리가 누락되었거나 작동하지 않을 경우 비프음 코드와 함께 "POST 실행 안 됨/화면이 표시되지 않음(No POST/No Video)" 증상이 생성되는 오류 등이 치명적인 오류에 해당됩니다.
- **간헐적으로 발생하는 오류** - 이러한 오류는 ESD 관련 오류의 약 80%를 차지합니다. 간헐적인 오류의 비율이 높다는 것은 손상이 발생했을 때 대부분 즉각적으로 인지할 수 없다는 것을 의미합니다. DIMM이 정전기 충격을 받았지만, 흔적을 거의 찾아볼 수 없으며, 손상과 관련된 외적인 증상이 즉각적으로 생성되지 않습니다. 몇 주 또는 몇 달이 지나면 흔적이 서서히 사라질 수 있으며 그러한 동안 메모리 무결성, 간헐적인 메모리 오류 등의 성능 저하가 발생할 수 있습니다.

인지하고 문제를 해결하기 어려운 손상 유형은 간헐적으로 발생하는 오류입니다. 이것은 잠복(잠재 또는 "walking wounded") 오류라고도 합니다.

ESD 손상을 방지하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 접지 처리가 제대로 된 유선 ESD 손목 접지대를 사용하십시오. 무선 정전기 방지 스트랩은 정전기 방지 기능이 충분하지 않기 때문에 더 이상 사용할 수 없습니다. 부품을 처리하기 전에 새시를 건드리면 ESD 손상에 대한 민감도가 증가하여 부품에 적절한 ESD 보호를 제공하지 않습니다.
- 정전기 방지 공간에서 정전기에 민감한 구성 요소를 다룹니다. 가능하면 정전기 방지 바닥 패드와 작업 패드를 사용하십시오.
- 정전기에 민감한 구성 요소의 포장을 푸는 경우, 부품 설치 준비를 한 후 정전기 방지 포장재에서 제품을 꺼내십시오. 정전기 방지 패키징을 풀려면 먼저 몸에 있는 정전기를 모두 제거해야 합니다.
- 정전기에 민감한 구성 요소를 운반하기 전에 정전기 방지 용기나 포장재에 넣습니다.

## ESD 현장 서비스 키트

모니터링되지 않는 현장 서비스 키트가 가장 일반적으로 사용되는 서비스 키트입니다. 각 현장 서비스 키트에는 세 가지 기본 구성 요소인 정전기 방지 매트, 손목 접지대, 본딩 와이어가 포함되어 있습니다.

### ESD 현장 서비스 키트의 구성 요소

ESD 현장 서비스 키트의 구성 요소는 다음과 같습니다.


- **정전기 방지 매트** - 정전기 방지 매트는 소산성이며 서비스 절차 중에 부품을 올려 놓을 수 있습니다. 정전기 방지 매트를 사용할 때 손목 접지대의 착용감이 좋아야 하며, 본딩 와이어가 작동 중인 시스템의 매트와 베어 메탈에 연결되어야 합니다. 적절히 배치하면 서비스 부품을 ESD 용기에서 분리하여 매트 위에 직접 놓을 수 있습니다. ESD에 민감한 구성 요소는 손 안, ESD 매트 위, 시스템 내부 또는 용기 안에서 안전합니다.
- **손목 접지대 및 본딩 와이어** - 손목 접지대 및 본딩 와이어는 ESD 매트가 필요하지 않을 경우에 하드웨어에서 손목 접지대와 베어 메탈 간에 직접 연결되거나 매트 위에 일시적으로 놓인 하드웨어를 보호하기 위해 정전기 방지 매트와 연결될 수 있습니다. 피부, ESD 매트 및 하드웨어 간에 손목 접지대와 본딩 와이어의 물리적인 연결을 본딩이라고 합니다. 손목 접지대, 매트, 본딩 와이어가 제공되는 현장 서비스 키트만 사용하십시오. 무선 손목 접지대는 사용하지 마십시오. 손목 접지대의 내부 전선은 일반적인 마모로 인해 손상되기 쉬우며 우발적인 ESD 하드웨어 손상을 방지하기 위해 손목 접지대 테스트를 사용하여 정기적으로 점검해야 합니다. 손목 접지대와 본딩 와이어는 최소 일주일에 한 번 점검하는 것이 좋습니다.
- **ESD 손목 접지대 테스트** - ESD 스트랩 내부의 전선은 시간이 경과하면 손상되기 쉽습니다. 모니터링되지 않는 키트를 사용하는 경우 각 서비스 콜을 이용하기 전에 최소 일주일에 한 번 스트랩을 정기적으로 검사하는 것이 좋습니다. 손목 접지대 테스트는 이러한 테스트를 수행하는 가장 효과적인 방법입니다. 손목 접지대 테스트가 없는 경우 지역 사무소에 재고가 있는지 문의하십시오. 테스트를 수행하려면, 손목 접지대의 본딩 와이어를 테스트에 연결하고 단추를 눌러 테스트를 시작합니다. 녹색 LED가 켜질 경우 테스트가 성공한 것이고, 빨간색 LED가 켜지거나 경고 소리가 나면 테스트에 실패한 것입니다.
- **절연체 요소** - 플라스틱 방열판 케이스 등과 같은 ESD에 민감한 장치는 정전기가 매우 잘 발생하는 절연체인 내부 부품과 멀리 분리해 놓아야 합니다.
- **작업 환경** - ESD 현장 서비스 키트를 배포하기 전에 고객의 입장에서 상황을 평가합니다. 예를 들어 서버 환경용 키트를 배포하는 것은 데스크탑 또는 노트북 환경용 키트를 배포하는 것과 다릅니다. 서버는 일반적으로 데이터 센터 내 랙에, 데스크탑 또는 노트북은 사무실 책상이나 사무 공간 내에 설치됩니다. 복구하려는 시스템 유형을 수용할 수 있는 추가 공간과 함께 ESD 키트를 배포하기에 충분한 작업 영역을 항상 찾아야 합니다. 이러한 작업 영역은 장애물이 없으며 평평하고 개방형 공간이어야 합니다. 또한 ESD를 일으키는 절연체도 없어야 합니다. 작업 영역에서 모든 하드웨어 구성 요소를 실제로 다루기 전에 스티로폼이나 그 외 플라스틱과 같은 절연체와 민감한 부품의 거리를 최소 30cm(12인치) 이상 유지해야 합니다.
- **ESD 포장** - 모든 ESD에 민감한 장치는 정전기 방지 포장으로 배송 및 제공되어야 합니다. 금속 정전기 방지 가방을 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 부품이 파손된 경우 항상 새 부품을 받은 것과 동일한 ESD 백 및 포장을 사용하여 해당 부품을 반품해야 합니다. ESD 백을 접은 후 테이프로 밀봉하고 들어 있던 것과 같은 포장 발포제와 함께 새 부품을 받은 원래 상자 안에 넣어야 합니다. ESD에 민감한 장치의 포장은 ESD 방지 작업대에서만 풀어야 하며, 부품을 절대 ESD 백 위에 놓아서는 안 됩니다. 백 안쪽에만 정전기 차폐 처리가 되어 있기 때문입니다. 부품은 항상 손에 잡고 있거나, ESD 매트 위에 놓거나, 시스템 또는 정전기 방지 가방 안에 넣으십시오.
- **민감한 구성 요소 운반** - ESD 민감한 구성 요소(예: 교체 부품 또는 Dell에 반환되는 부품)를 운반할 때는 안전한 운반을 위해 해당 부품을 정전기 방지 가방 안에 넣어야 합니다.

### ESD 보호 요약

모든 현장 서비스 기사는 Dell 제품을 수리할 때 항상 기존의 유선 ESD 손목 접지선 및 정전기 방지 매트를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 기사는 서비스를 수행하는 동안 민감한 부품을 모든 절연체와 분리시켜 두어야 하며, 민감한 구성 요소를 운반할 때는 정전기 방지 가방을 사용해야 합니다.

## 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에

### 이 작업 정보

 **주의:** 컴퓨터 내부에 나사가 남아 있거나 느슨한 나사가 존재하는 경우 컴퓨터가 심각하게 손상될 수 있습니다.

### 단계

1. 나사를 모두 장착하고 컴퓨터 내부에 남아 있는 나사가 없는지 확인합니다.
2. 컴퓨터 작업을 시작하기 전에 분리한 모든 외부 디바이스, 주변 디바이스 및 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
3. 컴퓨터 작업을 시작하기 전에 분리한 모든 미디어 카드, 디스크 및 기타 부품을 다시 장착합니다.
4. 전원 콘센트에 컴퓨터와 연결된 모든 디바이스를 연결합니다.

5. 컴퓨터를 켭니다.

## 기술 및 구성 요소

이 장에서는 시스템에서 사용 가능한 기술 및 구성 요소를 자세히 설명합니다.

### 주제:

- 그래픽 옵션
- 시스템 관리 기능

## 그래픽 옵션

### 인텔 UHD 610 그래픽

표 1. 인텔 UHD 610 그래픽 사양

인텔 UHD 610 그래픽	
버스 유형	내장형
메모리 유형	UMA
그래픽 수준	Celeron/Pentium 골드: GT2(UHD)
오버레이 플레인	예
운영 체제 그래픽/비디오 API 지원	DirectX 12, OpenGL(인텔 CML POR에서 4.5)
최대 해상도 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP: 60Hz에서 4096 x 2304, 24bpp</li> <li>• DP 옵션: 60Hz에서 4096 x 2304</li> <li>• USB Type-C 대체 모드 옵션: 60Hz에서 4096 x 2304</li> <li>• VGA 옵션: 60Hz에서 1920 x 1200</li> <li>• HDMI2.0 옵션: 60Hz에서 4096 x 2160</li> </ul>
지원되는 디스플레이의 수	최대 3대의 디스플레이 지원
다중 디스플레이 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2개의 마더보드 내장형 DP1.4 HBR2 + 1개의 비디오 옵션 (VGA/DP1.4 HBR2/HDMI2.0/USB3.2 Gen2 Type-C 대체 모드)</li> </ul>
외부 커넥터	2개의 MB 내장형 DP1.4 HBR2 + 1개의 비디오 옵션(VGA/DP1.4 HBR2/HDMI2.0/USB3.2 Gen2 Type-C 대체 모드)

### 인텔 UHD 630 그래픽

표 2. 인텔 UHD 630 그래픽 사양

인텔 UHD 630 그래픽	
버스 유형	내장형
메모리 유형	UMA
그래픽 수준	
오버레이 플레인	예
운영 체제 그래픽/비디오 API 지원	DirectX 12, OpenGL(인텔 CML POR에서 4.5)

표 2. 인텔 UHD 630 그래픽 사양 (계속)

인텔 UHD 630 그래픽	
최대 해상도 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP: 60Hz에서 4096 x 2304, 24bpp</li> <li>• DP 옵션: 60Hz에서 4096 x 2304</li> <li>• USB Type-C 대체 모드 옵션: 60Hz에서 4096 x 2304</li> <li>• VGA 옵션: 60Hz에서 1920 x 1200</li> <li>• HDMI2.0 옵션: 60Hz에서 4096 x 2160</li> </ul>
지원되는 디스플레이의 수	최대 3대의 디스플레이 지원
다중 디스플레이 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2개의 마더보드 내장형 DP1.4 HBR2 + 1개의 비디오 옵션 (VGA/DP1.4 HBR2/HDMI2.0/USB3.2 Gen2 Type-C 대체 모드)</li> </ul>
외부 커넥터	2개의 MB 내장형 DP1.4 HBR2 + 1개의 비디오 옵션 (VGA/DP1.4 HBR2/HDMI2.0/USB3.2 Gen2 Type-C 대체 모드)

## NVIDIA GeForce GT 730

표 3. NVIDIA GeForce GT 730 사양

기능	값
GPU 주파수	902MHz
DirectX	12.0
셰이더 모델	5.0
개방형 CL	1.1
개방형 GL	4.5
GPU 메모리 인터페이스	64비트
PCIe 버스	PCIe 3.0 x8
디스플레이 지원	1개의 DisplayPort 1.2
그래픽 메모리 구성	2GB, GDDR5
그래픽 메모리 클럭 속도	2.5GHz
활성 팬 싱크	2핀 제외 팬 컨트롤러
슬롯 번호	단일 슬롯
PCB 폼 팩터	로우 프로파일
PCB 계층	4개의 레이어
PCB 솔더 마스크	녹색
브래킷 폼 팩터	로우 프로파일
최대 해상도	3840 x 2160
전력 소비량	u <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20W TDP</li> </ul>

표 3. NVIDIA GeForce GT 730 사양 (계속)

기능	값
	30W TGP
3DMark 성능	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3DMark 11(P): E4131</li> <li>• 3Dmark Vantage(P):</li> </ul>

## AMD Radeon RX 640

표 4. AMD Radeon RX 640 사양

기능	값
GPU 주파수	1.2GHz
DirectX	12
셰이더 모델	5.0
개방형 CL	2.0
개방형 GL	4.5
GPU 메모리 인터페이스	128비트
PCIe 버스	PCIe 3.0 x8
디스플레이 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2개의 미니 DisplayPort</li> <li>• DisplayPort 1개</li> </ul>
그래픽 메모리 구성	4GB, GDDR5
그래픽 메모리 클럭 속도	7Gbps
활성 팬 싱크	4핀 내장형 팬 컨트롤러
슬롯 번호	단일 슬롯
PCB 폼 팩터	로우 프로파일
PCB 계층	6계층
PCB 솔더 마스크	녹색
브래킷 폼 팩터	로우 프로파일
최대 해상도	5120 x 2880
전력 소비량	50W
3DMark 성능	3DMark 11(P): 5315

# AMD Radeon R5 430

표 5. AMD Radeon R5 430 사양

기능	값
GPU 주파수	780MHz
DirectX	11.2
셰이더 모델	5.0
개방형 CL	1.2
개방형 GL	4.2
GPU 메모리 인터페이스	64비트
PCIe 버스	PCIe 3.0 x8
디스플레이 지원	2개의 DisplayPort
그래픽 메모리 구성	2GB, GDDR5
그래픽 메모리 클럭 속도	1.5GHz
활성 팬 싱크	2핀 제외 팬 컨트롤러
슬롯 번호	단일 슬롯
PCB 폼 팩터	로우 프로파일
PCB 계층	6계층
PCB 솔더 마스크	녹색
브래킷 폼 팩터	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전체 높이</li> <li>● 로우 프로파일</li> </ul>
최대 해상도	4096 x 2160
전력 소비량	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 25W TDP</li> <li>● 35W TGP</li> </ul>
3DMark 성능	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 3DMark 11(P)</li> <li>● 3Dmark Vantage(P)</li> </ul>

## 시스템 관리 기능

Dell 상용 시스템에는 Dell Client Command Suite와 함께 인밴드 관리를 위해 기본적으로 포함되어 있는 다양한 시스템 관리 옵션이 제공됩니다. 인밴드 관리는 시스템에 작동하는 운영 체제가 있고 디바이스가 네트워크에 연결되어 관리할 수 있는 경우입니다. Dell Client Command Suite는 개별적으로 또는 SCCM, LANDESK, KACE 등과 같은 시스템 관리 콘솔과 함께 활용할 수 있습니다.

또한 아웃오브밴드(Out-of-Band) 관리도 옵션으로 제공합니다. 아웃오브밴드(Out-of-Band) 관리는 시스템에 작동 중인 운영 체제가 없거나 전원이 꺼져 있으며 그 상태에서 시스템을 계속 관리하려는 경우를 의미합니다.

## 인밴드(In-Band) 시스템 관리용 Dell Client Command Suite

**Dell Client Command Suite**는 [dell.com/support](http://dell.com/support)에서 다운로드할 수 있는 모든 Latitude Rugged 태블릿용 무료 툴킷으로, 시스템 관리 작업을 자동화 및 효율화하여 시간, 비용, 리소스를 절감합니다. 독립적으로 또는 SCCM과 같은 다양한 시스템 관리 콘솔과 함께 사용할 수 있는 다음 모듈로 구성됩니다.

Dell Client Command Suite의 VMware Workspace ONE Powered by AirWatch와 통합으로 고객은 단일 Workspace ONE 콘솔을 사용하여 클라우드에서 Dell 클라이언트 하드웨어를 관리할 수 있습니다.

**Dell Command | Deploy**는 모든 주요 OS 배포 방법에서 쉬운 OS(Operating System) 배포가 가능하며 추출되어 OS 사용 가능 상태로 축소된 수많은 시스템별 드라이버를 제공합니다.

**Dell Command | Configure**는 사전 OS 또는 사후 OS 환경에서 하드웨어 설정을 구성 및 배포하기 위한 GUI(Graphical User Interface) 관리 툴로, SCCM 및 Airwatch와 원활하게 작동하며 LANDesk 및 KACE에 자체 통합될 수 있습니다. 간단히 말해, 이 툴은 BIOS에 관한 것입니다. Command | Configure를 사용하면 개인화된 사용자 환경을 위해 150개 이상의 BIOS 설정을 원격으로 자동화하고 구성할 수 있습니다.

**Dell Command | PowerShell Provider**는 Command | Configure와 동일한 작업을 수행할 수 있지만 다른 방법을 사용합니다. PowerShell은 고객이 사용자 지정 및 동적 구성 프로세스를 만들 수 있는 스크립팅 언어입니다.

**Dell Command | Monitor**는 IT 관리자에게 하드웨어 및 상태 데이터의 광범위한 인벤토리를 제공하는 WMI(Windows Management Instrumentation) 에이전트입니다. 관리자는 명령줄 및 스크립팅을 사용하여 하드웨어를 원격으로 구성할 수도 있습니다.

**Dell Command | Power Manager(최종 사용자 툴)**는 출하시 설치된 GUI 기반 배터리 관리 툴로써, 그룹 정책으로 이러한 설정을 제어하는 IT 기능에 영향을 주지 않으면서 최종 사용자가 개인 선호 사항 또는 작업 예약에 맞는 배터리 관리 방법을 선택할 수 있게 합니다.

**Dell Command | Update(최종 사용자 툴)**는 공장 출하시 설치되어 있으며 관리자가 BIOS, 드라이버, 소프트웨어에 대한 Dell 업데이트를 개별적으로 관리하고 자동으로 제공 및 설치할 수 있습니다. Command | Update는 업데이트 설치의 시간을 소모하는 키보드 입력 프로세스를 제거합니다.

**Dell Command | Update Catalog**는 관리 콘솔이 최신 시스템별 업데이트(드라이버, 펌웨어 또는 BIOS)를 검색할 수 있는 검색 가능한 메타데이터를 제공합니다. 업데이트는 SCCM과 같은 카탈로그를 사용하는 고객의 시스템 관리 인프라를 사용하여 최종 사용자에게 원활하게 전달됩니다.

**Dell Command | vPro Out of Band** 콘솔은 하드웨어 관리를 오프라인 상태이거나 도달할 수 없는 OS(Dell 독점 기능)가 있는 시스템으로 확장합니다.

**Dell Command | Integration Suite for System Center** - 이 제품군은 Client Command Suite의 모든 주요 구성 요소를 Microsoft System Center Configuration Manager 2012 및 현재 분기 버전에 통합합니다.

## 현장 서비스 정보

### 주제:


- 측면 덮개
- 전면 베젤
- 하드 드라이브 어셈블리
- 솔리드 스테이트 드라이브
- WLAN 카드
- 슬림 옵티컬 드라이브
- 방열판
- 코인 셀 배터리
- 메모리 모듈
- 프로세서
- 시스템 보드

## 측면 덮개

### 측면 커버 제거

#### 전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.

 **노트:** 보안 케이블 슬롯에서 보안 케이블을 제거해야 합니다(해당하는 경우).

#### 이 작업 정보

다음 이미지는 측면 패널의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.

1



2



### 단계

1. 딸깍 소리가 날 때까지 릴리스 래치를 아래로 누릅니다.
2. 측면 커버를 시스템 뒤쪽으로 밀습니다.
3. 측면 커버를 시스템에서 들어 올립니다.

## 측면 커버 설치

### 전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

### 이 작업 정보

다음 이미지는 측면 패널의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



## 단계

1. 컴퓨터에서 측면 커버 슬롯을 찾습니다.
2. 릴리스 래치에서 딸깍 소리가 날 때까지 측면 커버를 시스템 전면으로 밀니다.

## 다음 단계

1. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

# 전면 베젤

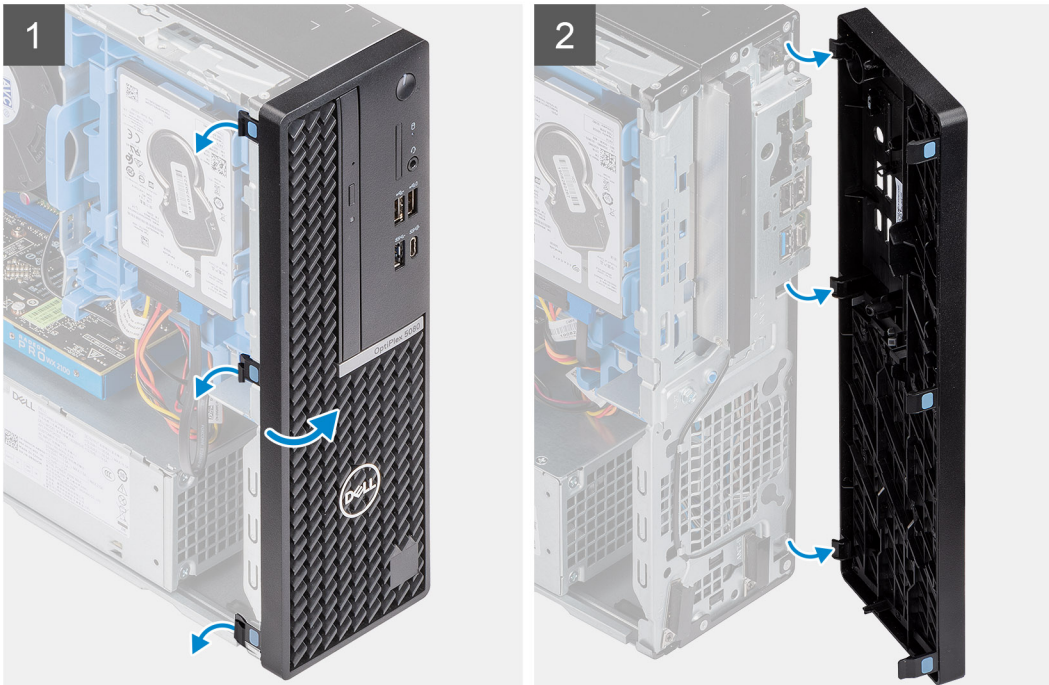
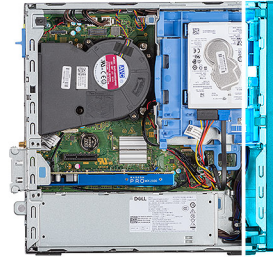
## 전면 베젤 제거

### 전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.

### 이 작업 정보

다음 이미지는 전면 베젤의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



## 단계

1. 고정 탭을 들어 올려 시스템에서 전면 베젤의 고정을 해제합니다.
2. 전면 베젤을 시스템에서 제거합니다.

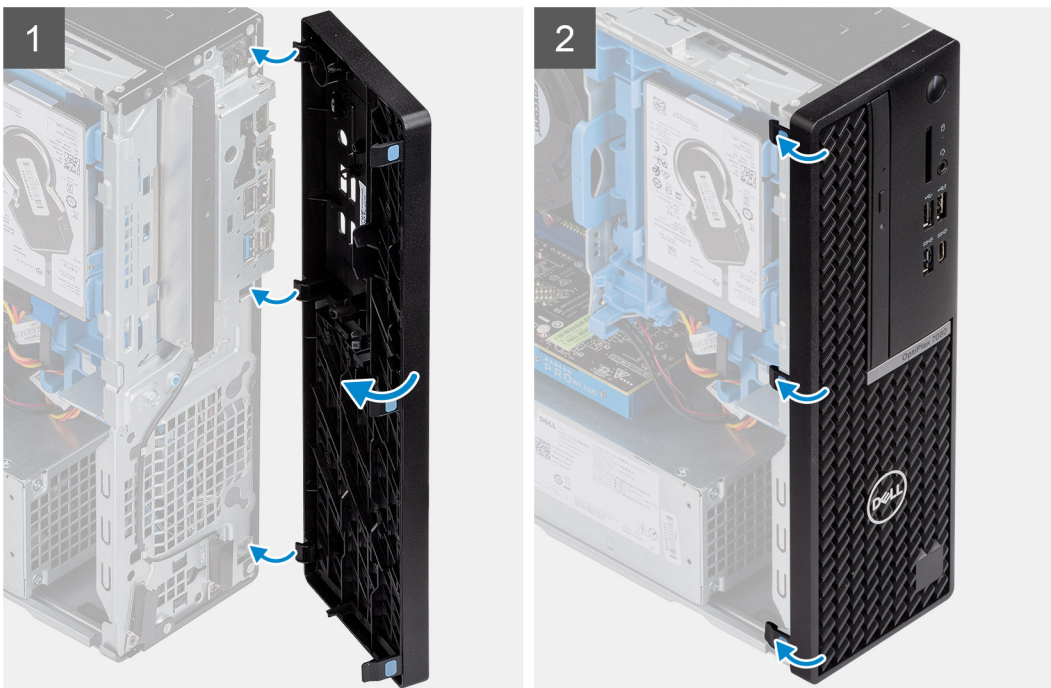
## 전면 베젤 설치

### 전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

### 이 작업 정보

다음 이미지는 전면 베젤의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



### 단계

1. 탭 홀더가 시스템 새시의 슬롯에 맞도록 베젤을 놓습니다.
2. 탭이 딸깍 소리를 내며 제자리에 끼워질 때까지 베젤을 누릅니다.

### 다음 단계

1. 측면 커버를 설치합니다.
2. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

## 하드 드라이브 어셈블리

### 2.5" 하드 드라이브 하드 드라이브 어셈블리

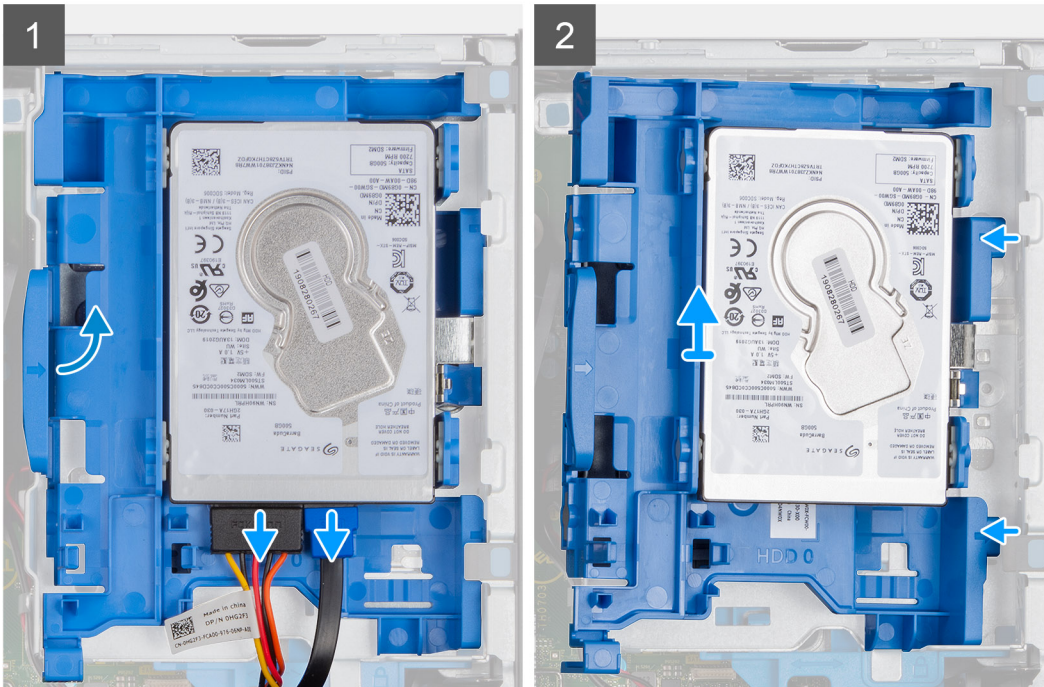
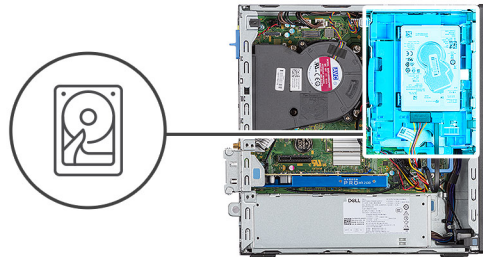
### 전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.

2. 측면 커버를 제거합니다.
3. 전면 베젤을 분리합니다.

### 이 작업 정보

다음 이미지는 2.5" 하드 드라이브의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



### 단계

1. 하드 드라이브 데이터 케이블 및 전원 케이블을 하드 드라이브의 커넥터에서 연결 해제합니다.
2. 6-32 나사를 제거합니다.
3. 하드 드라이브 어셈블리를 노치에서 릴리스하고 하드 드라이브 어셈블리를 밀어 꺼냅니다.

**이** **노트:** 향후 올바른 재장착을 위해 하드 드라이브의 방향을 기록해 둡니다.

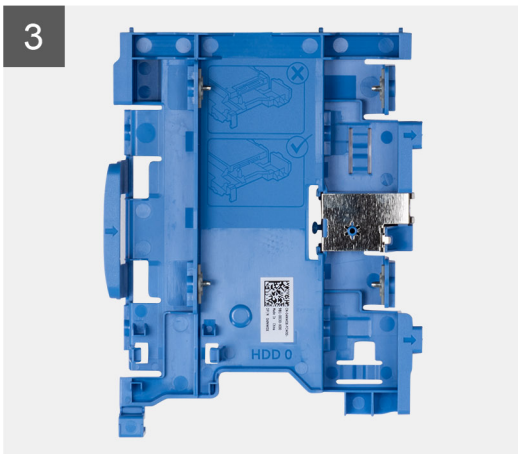
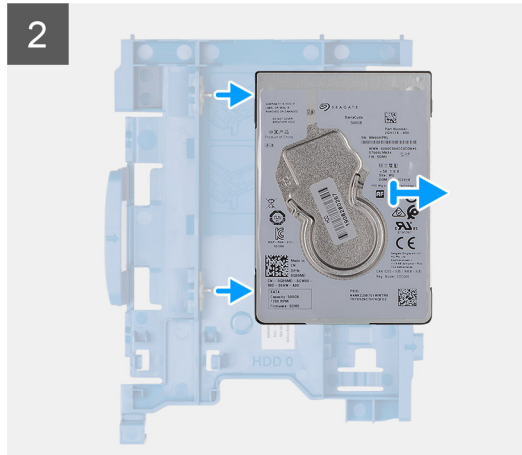
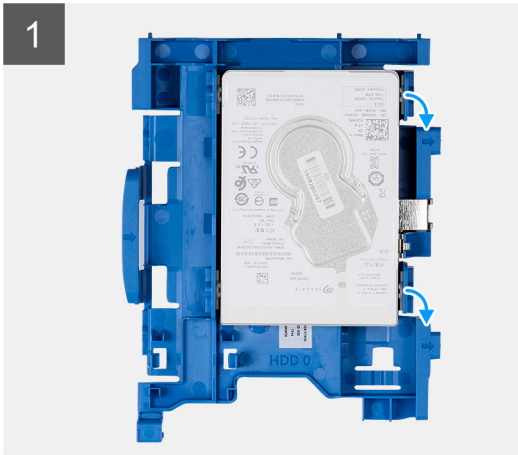
## 하드 드라이브 브래킷 분리

### 전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
3. 전면 베젤을 분리합니다.
4. 2.5" 하드 드라이브 어셈블리를 제거합니다.

### 이 작업 정보

다음 이미지는 하드 드라이브 케이스의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



### 단계

1. 컴퓨터의 하드 드라이브 브래킷을 찾습니다.
2. 8개의 M3x3 나사를 하드 드라이브 브래킷에서 제거합니다.

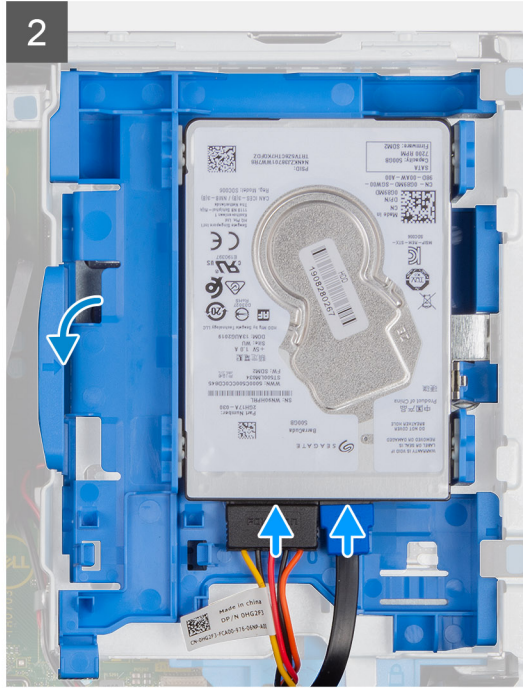
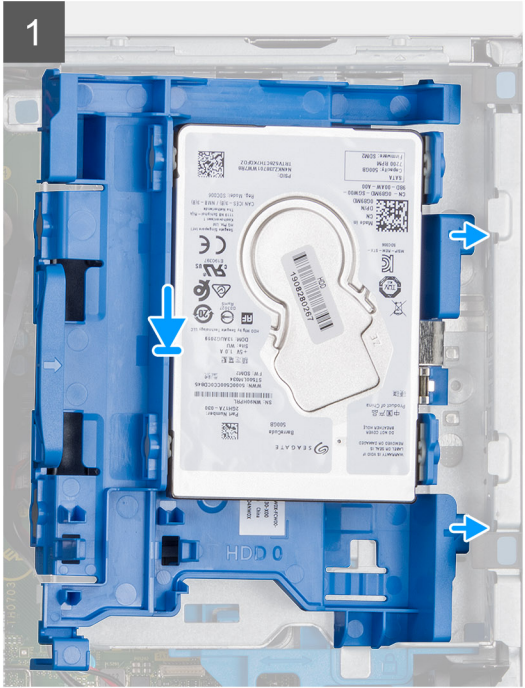
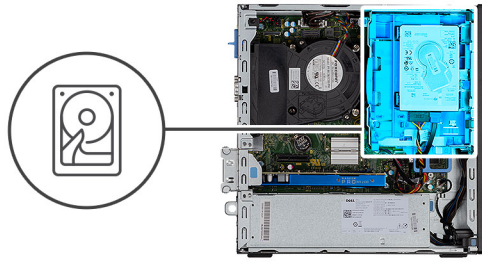
## 설치: 2.5" 하드 드라이브 어셈블리

### 전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

### 이 작업 정보

다음 이미지는 2.5" 하드 드라이브의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



### 단계

1. 하드 드라이브 어셈블리를 시스템의 슬롯에 삽입하고 하드 드라이브 어셈블리를 아래로 밀습니다.
2. 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 하드 드라이브 어셈블리를 아래로 누릅니다.
3. 6-32 나사를 장착하여 하드 드라이브 어셈블리를 고정합니다.
4. 전원 케이블과 하드 드라이브 케이블을 하드 드라이브의 커넥터에 연결합니다.

### 다음 단계

1. 전면 베젤을 설치합니다.
2. 측면 커버를 설치합니다.
3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

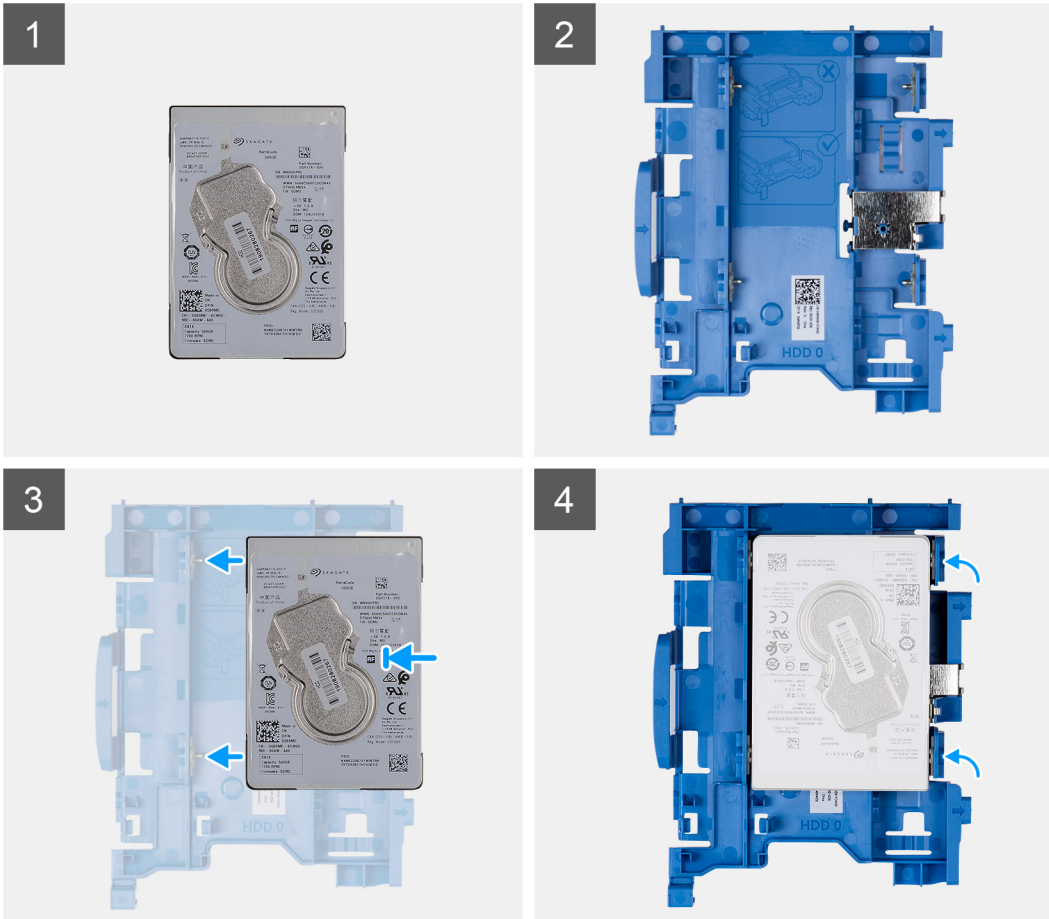
## 하드 드라이브 브래킷 설치

### 전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

### 이 작업 정보

다음 이미지는 하드 드라이브 케이스의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



### 단계

1. 8개의 M3x3 나사를 장착하여 하드 드라이브 브래킷을 고정합니다.
2. 드라이브 브래킷을 드라이브의 슬롯에 맞추어 삽입합니다.

### 다음 단계

1. 2.5" 하드 드라이브 어셈블리를 제거합니다.
2. 전면 베젤을 설치합니다.
3. 측면 커버를 설치합니다.
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

## 솔리드 스테이트 드라이브

### M.2 2230 PCIe 솔리드 스테이트 드라이브 제거

#### 전제조건

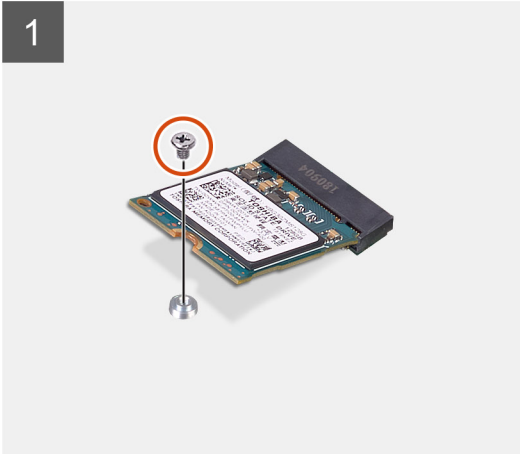
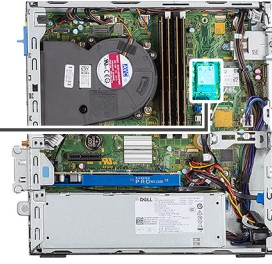
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
3. 전면 베젤을 분리합니다.
4. 2.5" 하드 드라이브 어셈블리를 제거합니다.

#### 이 작업 정보

다음 이미지는 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



1x  
M2x3



#### 단계

1. SSD를 시스템 보드에 고정하는 나사(M2x3)를 분리합니다.
2. SSD를 밀어 올려 시스템 보드에서 분리합니다.

## M.2 2230 PCIe 솔리드 스테이트 드라이브 설치

#### 전제조건

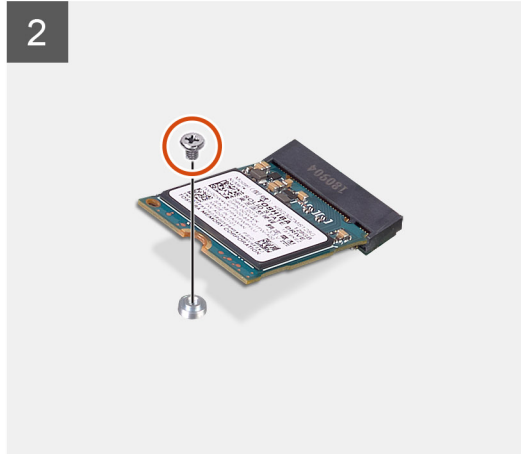
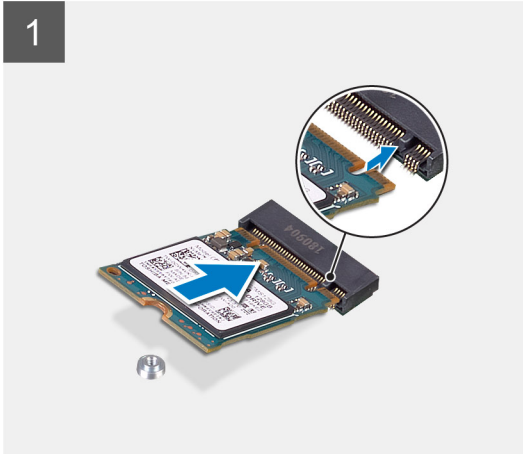
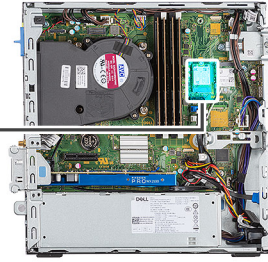
구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

#### 이 작업 정보

다음 이미지는 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



1x  
M2x3



#### 단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브의 노치를 솔리드 스테이트 드라이브 슬롯의 탭에 맞춥니다.
2. SSD를 45도 각도로 시스템 보드에 밀어 넣습니다.
3. M.2 PCIe 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드에 고정하는 M2X3 나사를 장착합니다.

#### 다음 단계

1. 2.5" 하드 드라이브 어셈블리를 제거합니다.
2. 전면 베젤을 설치합니다.
3. 측면 커버를 설치합니다.
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

## M.2 2280 PCIe 솔리드 스테이트 드라이브 제거

#### 전제조건

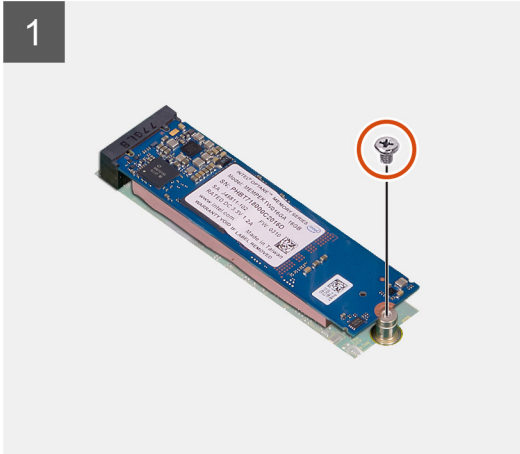
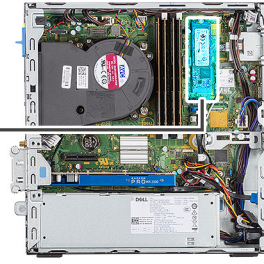
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
3. 전면 베젤을 분리합니다.
4. 2.5" 하드 드라이브 어셈블리를 제거합니다.

#### 이 작업 정보

다음 이미지는 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



1x  
M2x3



#### 단계

1. SSD를 시스템 보드에 고정하는 나사(M2x3)를 분리합니다.
2. SSD를 밀어 올려 시스템 보드에서 분리합니다.

## M.2 2280 PCIe 솔리드 스테이트 드라이브 설치

#### 전제조건

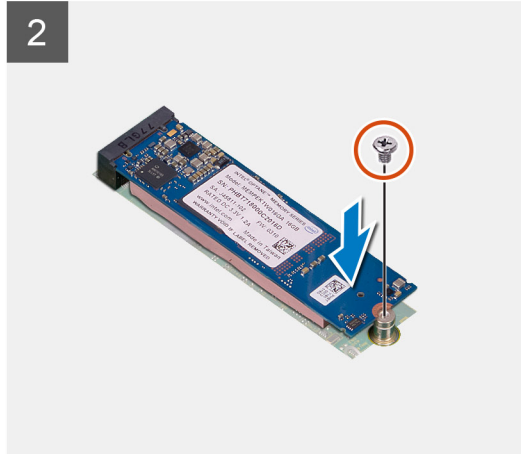
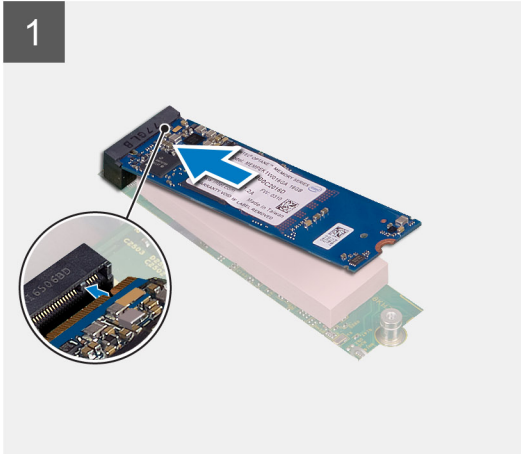
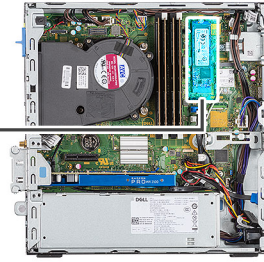
구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

#### 이 작업 정보

다음 이미지는 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



1x  
M2x3



#### 단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브의 노치를 솔리드 스테이트 드라이브 슬롯의 탭에 맞춥니다.
2. SSD를 45도 각도로 시스템 보드에 밀어 넣습니다.
3. M.2 PCIe 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드에 고정하는 M2X3 나사를 장착합니다.

#### 다음 단계

1. 2.5" 하드 드라이브 어셈블리를 설치합니다.
2. 전면 베젤을 설치합니다.
3. 측면 커버를 설치합니다.
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

## WLAN 카드

### WLAN 카드 제거

#### 전제조건

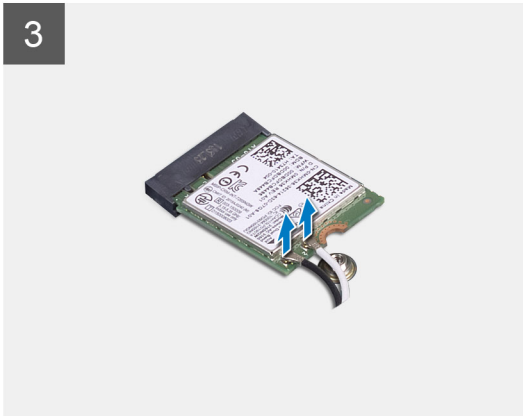
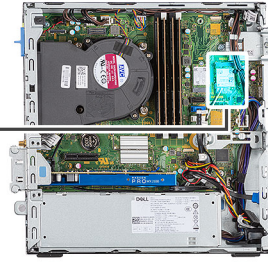
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
3. 전면 베젤을 분리합니다.
4. 2.5" 하드 드라이브 어셈블리를 제거합니다.

#### 이 작업 정보

다음 이미지는 무선 카드의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



1x  
M2x3



### 단계

1. WLAN 카드를 시스템 보드에 고정하는 나사(M2x3)를 제거합니다.
2. WLAN 카드 브래킷을 들어 올려 WLAN 카드에서 분리합니다.
3. 안테나 케이블을 WLAN 카드에서 연결 해제합니다.
4. WLAN 카드를 밀어 시스템 보드의 커넥터에서 제거합니다.

## WLAN 카드 설치

### 전제조건

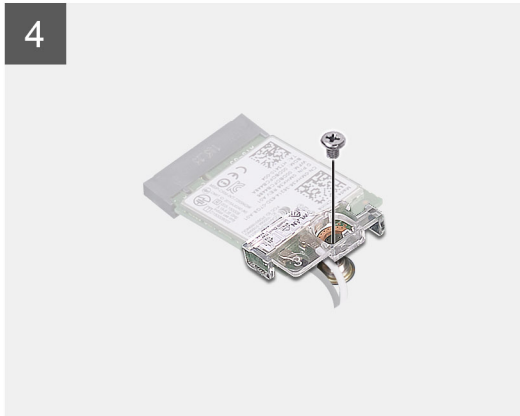
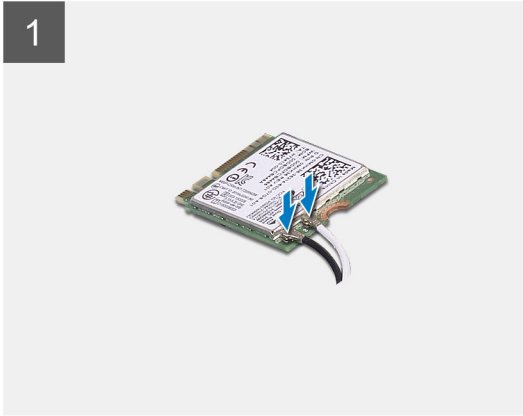
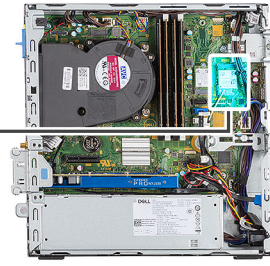
구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

### 이 작업 정보

다음 그림은 무선 카드의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



1x  
M2x3



### 단계

1. WLAN 카드에 안테나 케이블을 연결합니다.  
다음 표에는 컴퓨터의 WLAN 카드의 안테나 케이블 색상표가 나와 있습니다.

**표 6. 안테나 케이블 색상표**

무선 카드의 커넥터	안테나 케이블 색상
주(흰색 삼각형)	흰색
보조(검정색 삼각형)	검정색

2. WLAN 카드 브래킷을 놓아 WLAN 케이블을 고정합니다.
3. WLAN 카드를 시스템 보드의 커넥터에 끼웁니다.
4. 나사(M2x3)를 장착하여 플라스틱 탭을 WLAN 카드에 고정합니다.

### 다음 단계

1. 2.5" 하드 드라이브 어셈블리를 제거합니다.
2. 전면 베젤을 설치합니다.
3. 측면 커버를 설치합니다.
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

# 슬림 옵티컬 드라이브

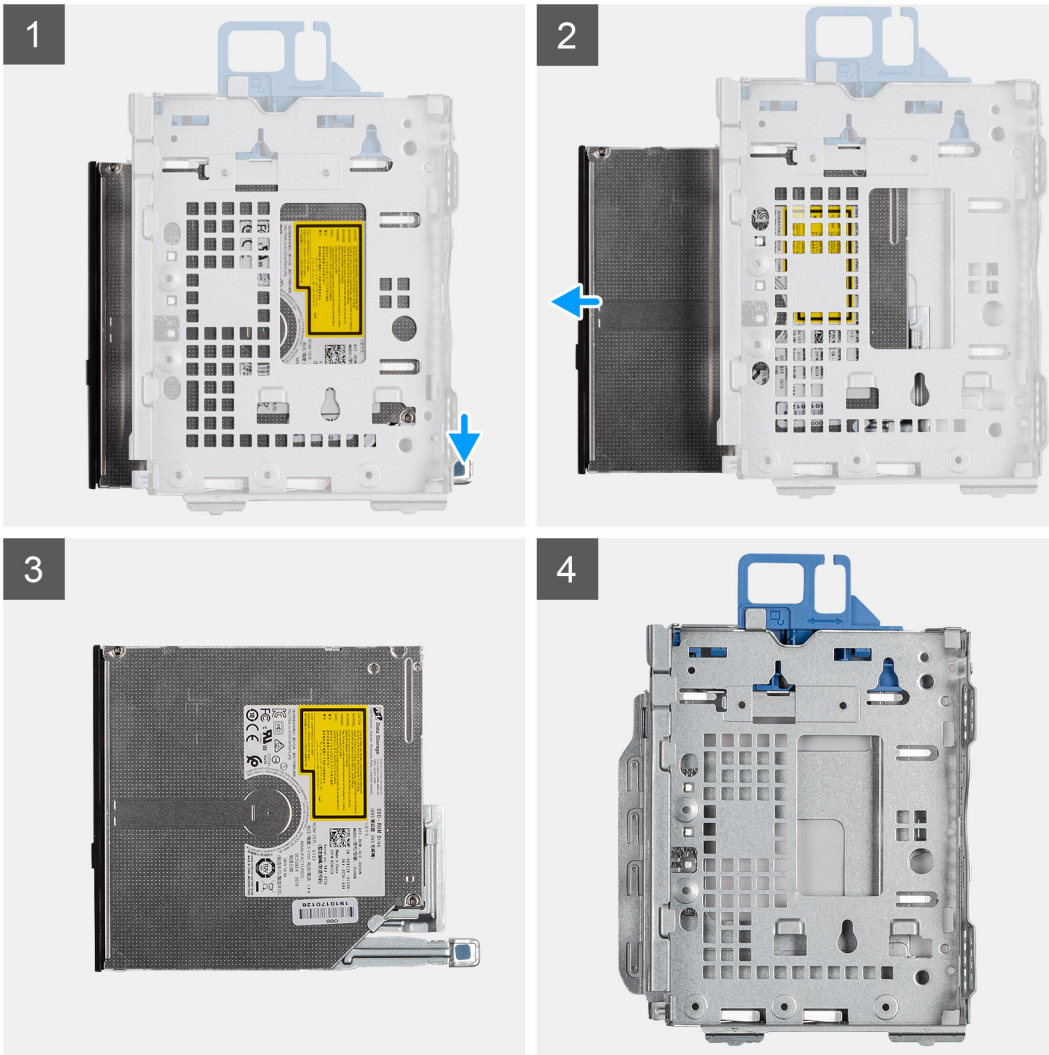
## 슬림 옵티컬 디스크 드라이브 제거

### 전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.

### 이 작업 정보

다음 이미지는 슬림 ODD의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



### 단계

1. 옵티컬 드라이브/하드 드라이브 모듈의 분리 탭을 누릅니다.
2. 옵티컬 드라이브를 옵티컬 드라이브/하드 드라이브 모듈에서 밀어냅니다.
3. 옵티컬 드라이브 유닛.
4. 옵티컬 드라이브/하드 드라이브 모듈.

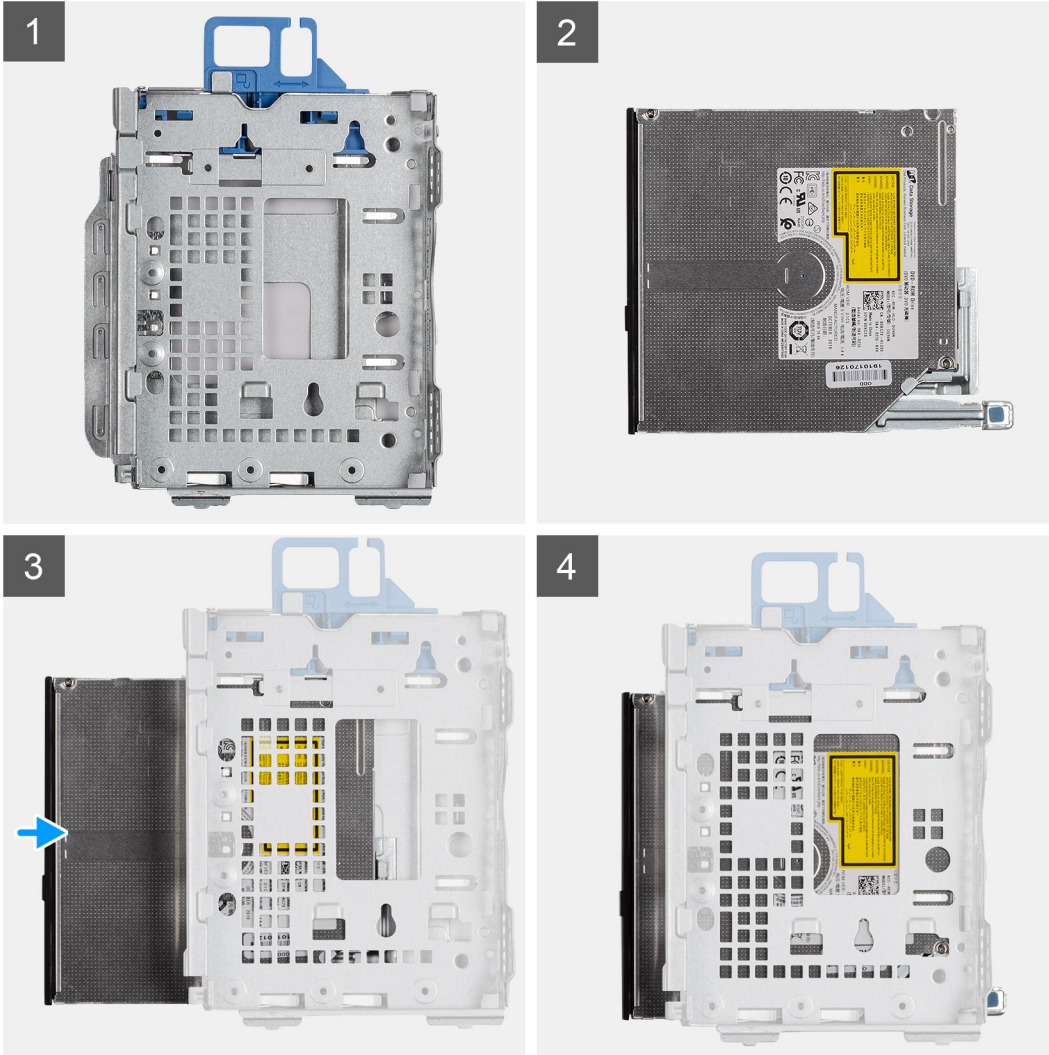
## 슬림 옵티컬 디스크 드라이브 설치

### 전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

### 이 작업 정보

다음 이미지는 슬림 ODD의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



### 단계

1. 옵티컬 드라이브/하드 드라이브 모듈
2. 옵티컬 드라이브 유닛.
3. 옵티컬 드라이브를 옵티컬 드라이브/하드 드라이브 모듈에 삽입합니다.
4. 딸깍 소리를 내며 제자리에 끼워질 때까지 옵티컬 드라이브 유닛을 누릅니다.

### 다음 단계

1. 측면 커버를 설치합니다.
2. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

# 방열판

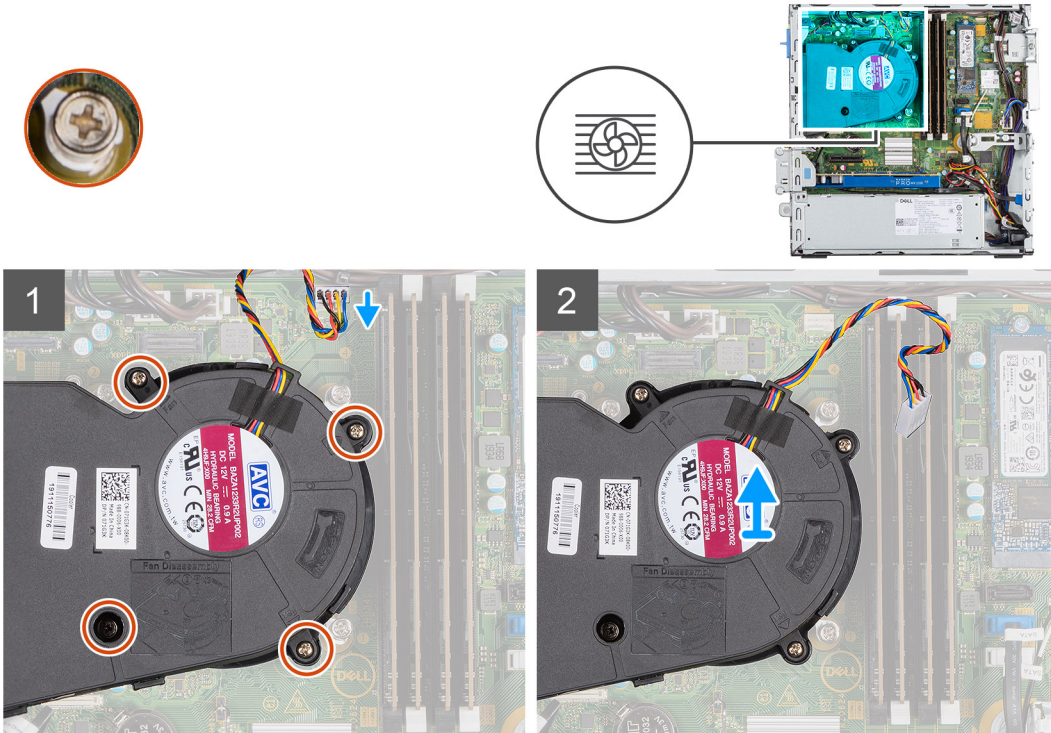
## 방열판 제거

### 전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
3. 전면 베젤을 분리합니다.

### 이 작업 정보

다음 이미지는 방열판의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



### 단계

1. 방열판 팬 케이블을 연결 해제하고 방열판을 시스템에 고정하는 4개의 캡티브 나사를 풀습니다.
2. 방열판을 시스템 보드에서 들어 올립니다.

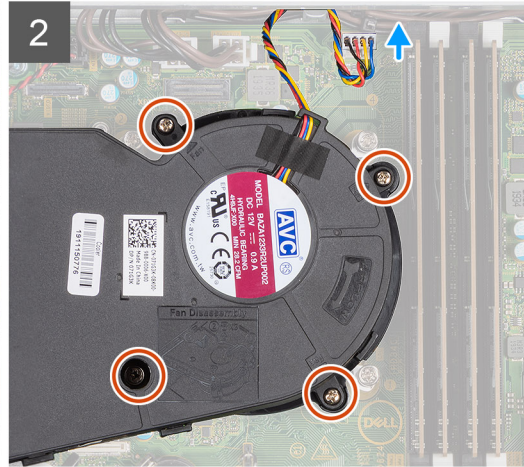
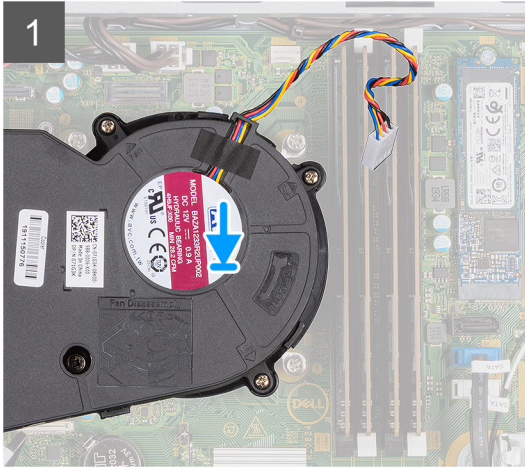
## 방열판 설치

### 전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

### 이 작업 정보

다음 이미지는 VR 방열판의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



### 단계

1. 프로세서에 방열판을 놓습니다.
2. 방열판을 시스템 보드에 고정하는 캡티브 나사를 조리고 방열판 팬 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.

### 다음 단계

1. 전면 베젤을 설치합니다.
2. 측면 커버를 설치합니다.
3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

## 코인 셀 배터리

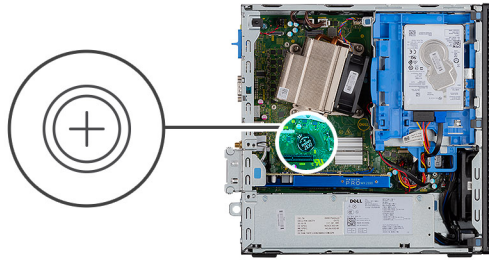
### 코인 셀 배터리 제거

#### 전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
3. 전면 베젤을 분리합니다.

#### 이 작업 정보

다음 이미지는 코인 셀 배터리의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



**단계**

1. 플라스틱 스크라이브로 코인 셀 배터리를 조심스럽게 들어 올려 시스템 보드의 슬롯에서 빼냅니다.
2. 코인 셀 배터리를 시스템에서 제거합니다.

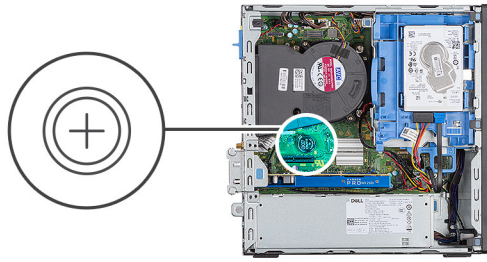
## 코인 셀 배터리 설치

**전제조건**

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

**이 작업 정보**

다음 그림은 코인 셀 배터리의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



#### 단계

1. "+" 기호가 위로 향하게 코인 셀 배터리를 삽입하고 커넥터 양극 쪽의 고정 탭 아래로 밀습니다.
2. 배터리가 제자리에 끼워질 때까지 커넥터 안으로 누릅니다.

#### 다음 단계

1. 전면 베젤을 설치합니다.
2. 측면 커버를 설치합니다.
3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

## 메모리 모듈

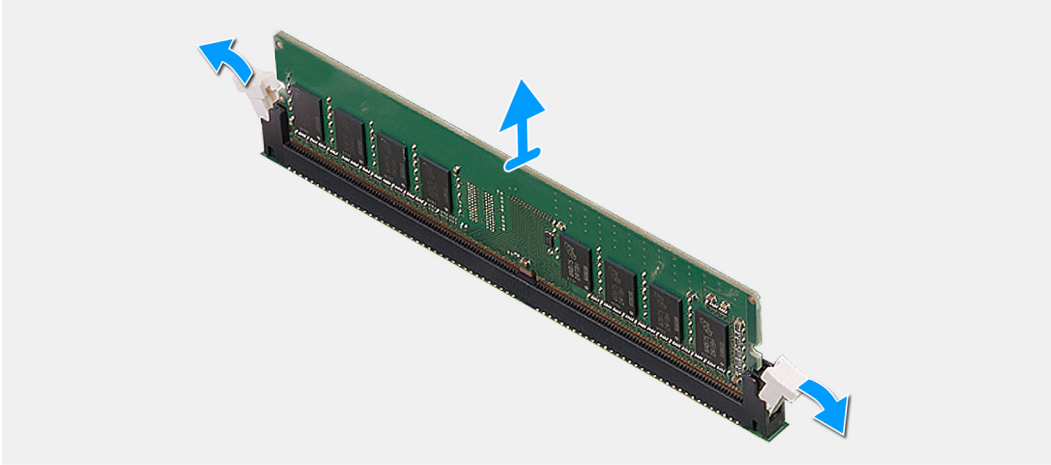
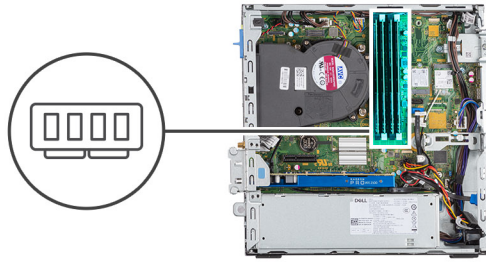
### 메모리 모듈 제거

#### 전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
3. 전면 베젤을 분리합니다.
4. 2.5" 하드 드라이브 어셈블리를 제거합니다.

#### 이 작업 정보

다음 그림은 메모리 모듈의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



#### 단계

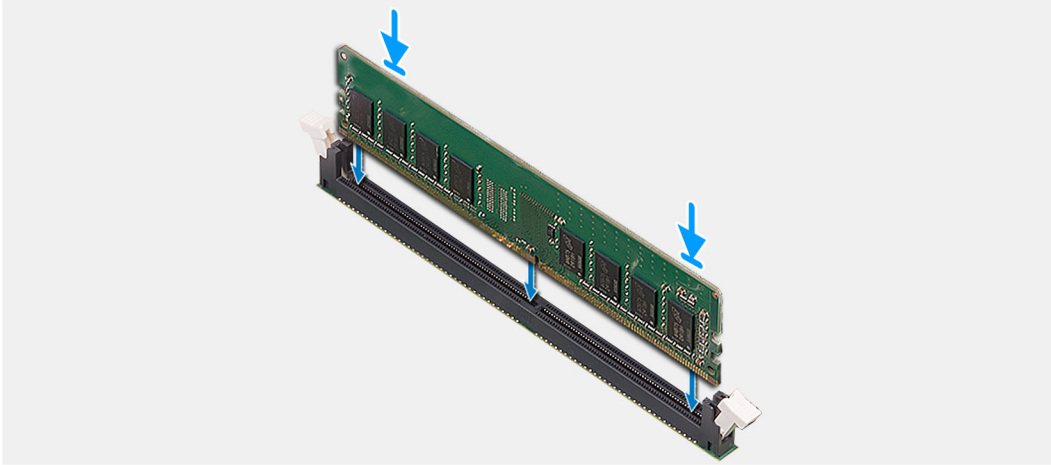
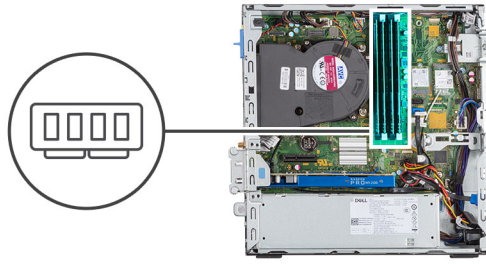
1. 메모리 모듈이 튀어나올 때까지 메모리 모듈에서 고정 클립을 잡아 당깁니다.
2. 메모리 모듈을 밀어 메모리 모듈 슬롯에서 분리합니다.

## 메모리 모듈 설치

#### 전제조건

#### 이 작업 정보

다음 이미지는 메모리 모듈의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



### 단계

1. 메모리 모듈의 노치를 메모리 모듈 슬롯의 탭에 맞춥니다.
2. 메모리 모듈을 일정 각도로 슬롯에 밀어 넣고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 메모리 모듈을 아래로 누릅니다.

**① | 노트:** 소리가 나지 않으면 메모리 모듈을 제거했다가 다시 설치합니다.

### 다음 단계

1. 2.5" 하드 드라이브 어셈블리를 설치합니다.
2. 전면 베젤을 설치합니다.
3. 측면 커버를 설치합니다.
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

## 프로세서

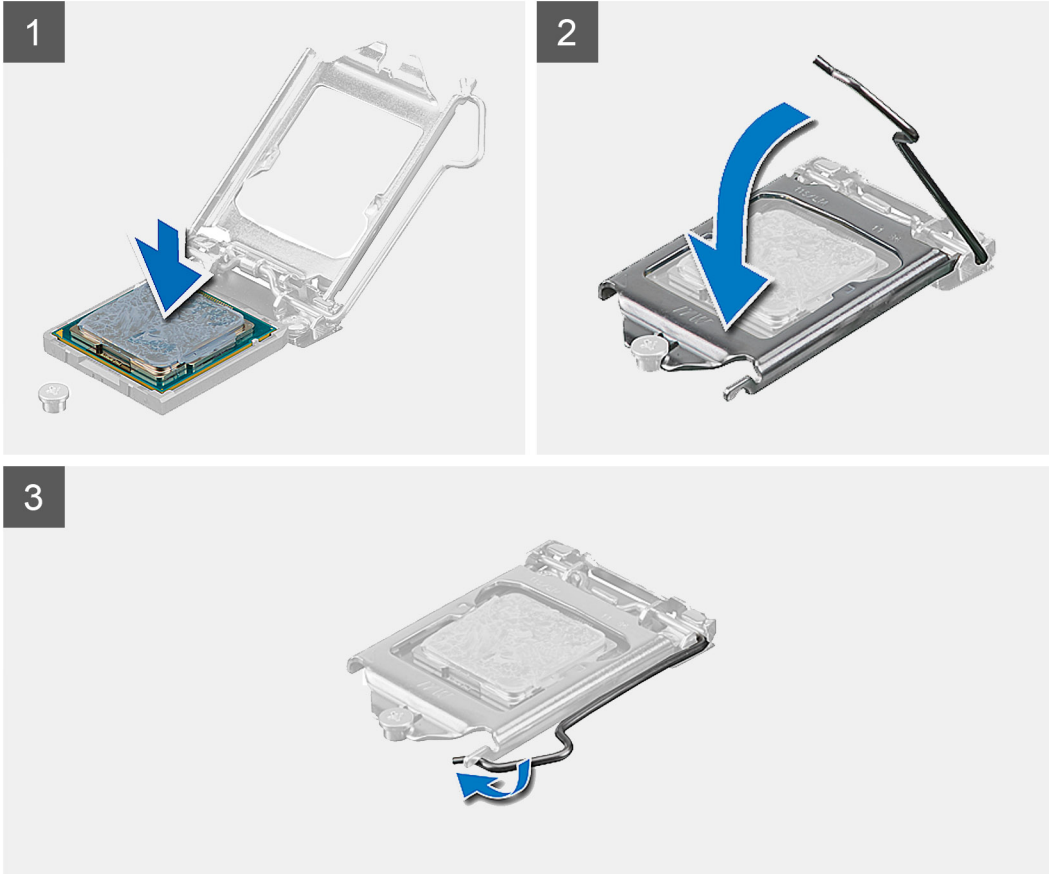
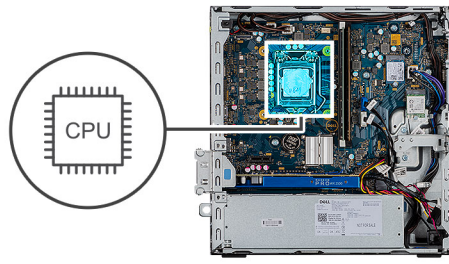
### 프로세서 설치

#### 전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

#### 이 작업 정보

다음 이미지는 프로세서의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



### 단계

1. 프로세서의 1핀 모서리를 프로세서 소켓의 1핀 모서리에 맞춘 후 프로세서를 프로세서 소켓에 놓습니다.
  - 이** **노트:** 프로세서의 1핀 모서리의 삼각형과 프로세서 소켓 1핀 모서리의 삼각형을 맞춥니다. 프로세서가 올바르게 장착되면 모서리 4개가 모두 동일한 높이로 맞춰집니다. 프로세서의 모서리 하나 이상이 다른 모서리보다 높으면 프로세서가 올바르게 장착되지 않은 것입니다.
2. 프로세서가 제대로 소켓에 위치했으면 프로세서 커버를 닫으십시오.
3. 탭 아래의 릴리스 레버를 아래로 누르고 밀어 고정시킵니다.

### 다음 단계

1. 방열판을 설치합니다.
2. 전면 베젤을 설치합니다.
3. 측면 커버를 설치합니다.
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

# 프로세서 제거

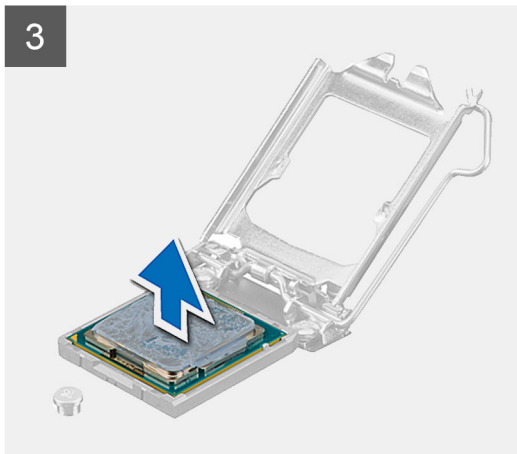
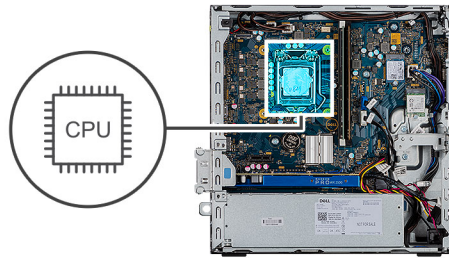
## 전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
3. 전면 베젤을 분리합니다.
4. 방열판을 제거합니다.

**이 노트:** 프로세서가 여전히 뜨거울 수 있으니 제거 절차를 시작하기 전에 프로세서가 냉각되도록 기다립니다.

## 이 작업 정보

다음 이미지는 프로세서의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



## 단계

1. 분리 레버를 아래로 누르고 프로세서에서 밀어 분리한 다음, 레버를 고정 탭에서 폼니다.
2. 레버를 위로 들어 올려 프로세서 커버를 들어 올립니다.

**주의:** 프로세서를 제거할 때 소켓 내 핀을 만지거나 물체가 소켓 내 핀에 떨어지지 않게 하십시오.

3. 프로세서를 프로세서 소켓에서 조심스럽게 들어 올립니다.

# 시스템 보드

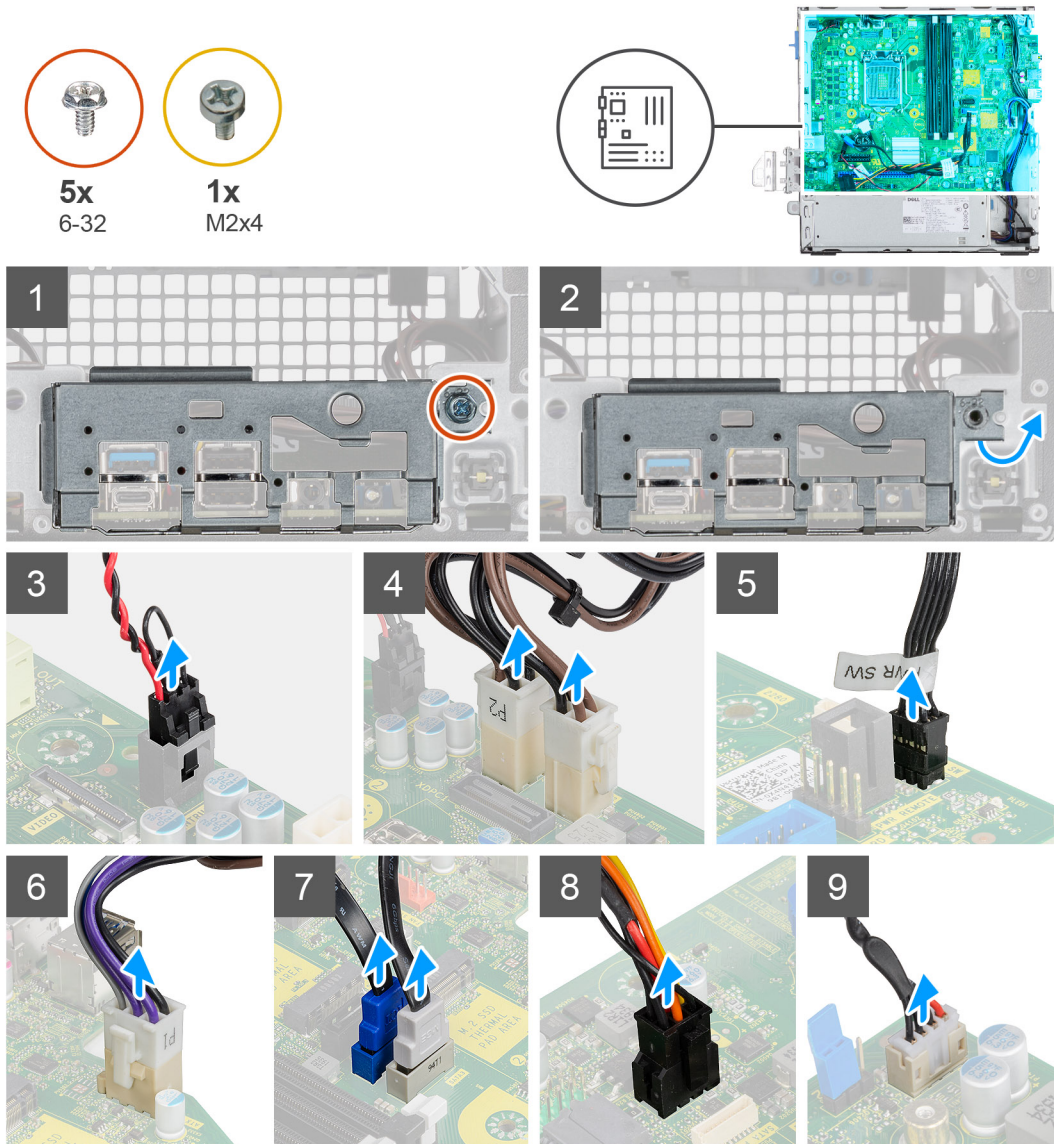
## 시스템 보드 제거

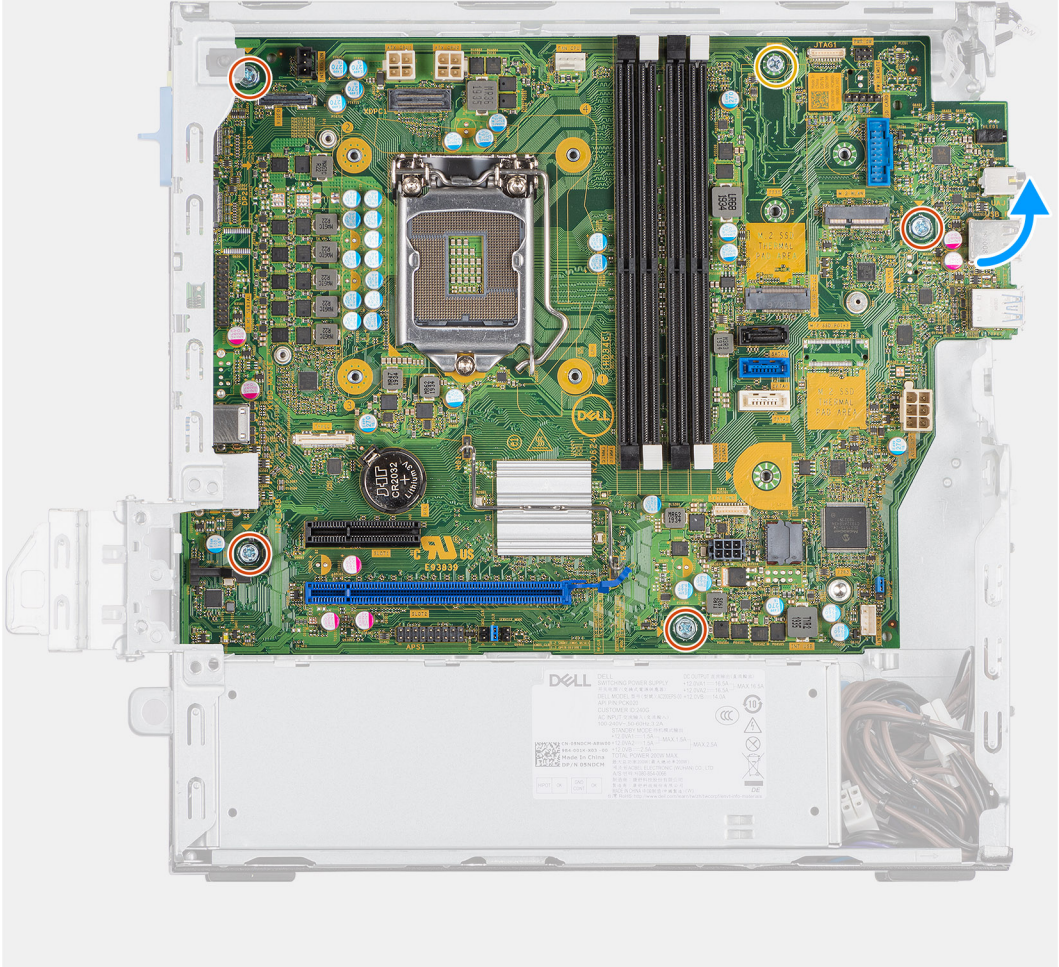
### 전제조건

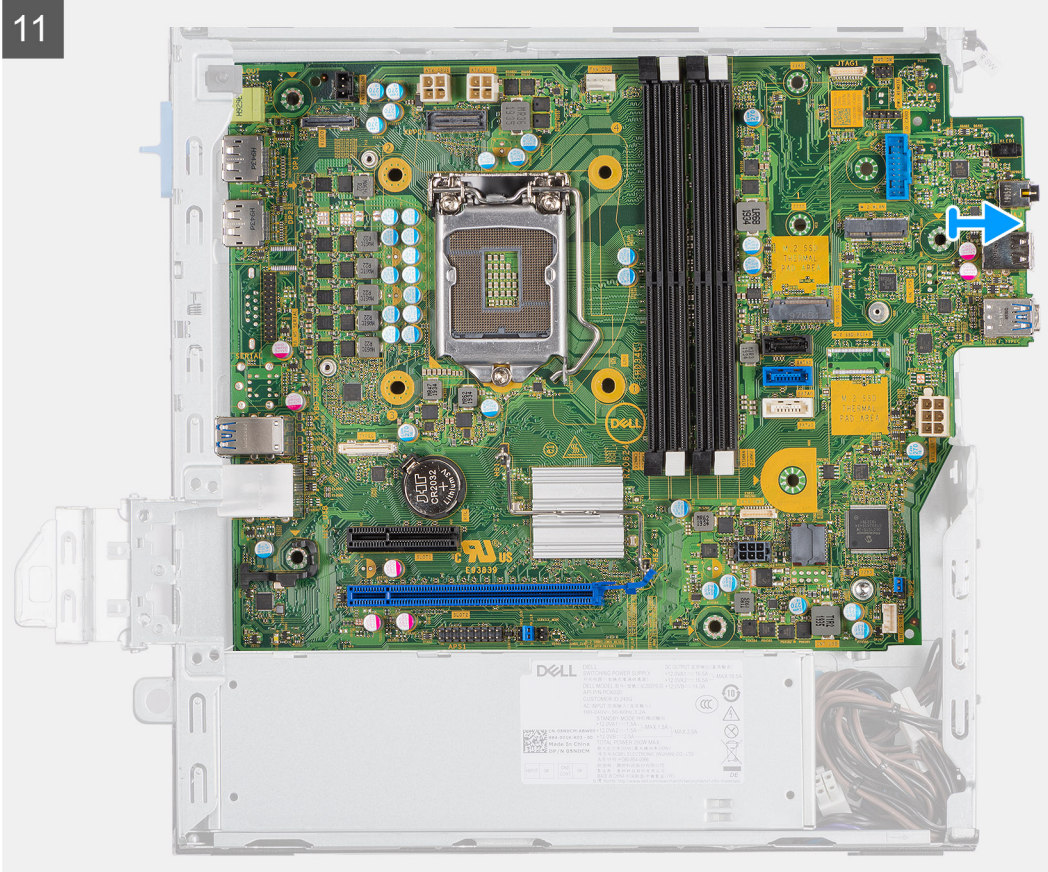
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
3. 전면 베젤을 분리합니다.
4. 하드 드라이브 어셈블리를 제거합니다.
5. 솔리드 스테이트 드라이브를 제거합니다.
6. WLAN 카드를 제거합니다.
7. 방열판을 제거합니다.
8. 메모리 모듈을 분리합니다.
9. 프로세서를 분리합니다.

### 이 작업 정보

다음 그림은 시스템 보드의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.







## 단계

1. I/O 패널을 고정하는 6-32 나사를 제거합니다.
2. I/O 패널을 들어 올려 시스템 보드에서 분리합니다.
3. 침입 스위치 케이블을 연결 해제합니다.
4. 시스템 보드 전원 공급 장치 케이블을 연결 해제합니다.
5. 전원 버튼 스위치 케이블을 연결 해제합니다.
6. 시스템 팬 케이블을 연결 해제합니다.
7. 프로세서 전원 공급 장치 케이블을 연결 해제합니다.
8. SATA 케이블을 연결 해제합니다.
9. SATA 전원 케이블을 연결 해제합니다.
10. 내부 스피커 케이블을 연결 해제합니다.
11. 4개의 나사(6-32)와 1개의 격리 애자 나사(M2X4)를 제거합니다.
12. 시스템 보드를 들어 올려 꺼냅니다.

## 시스템 보드 설치

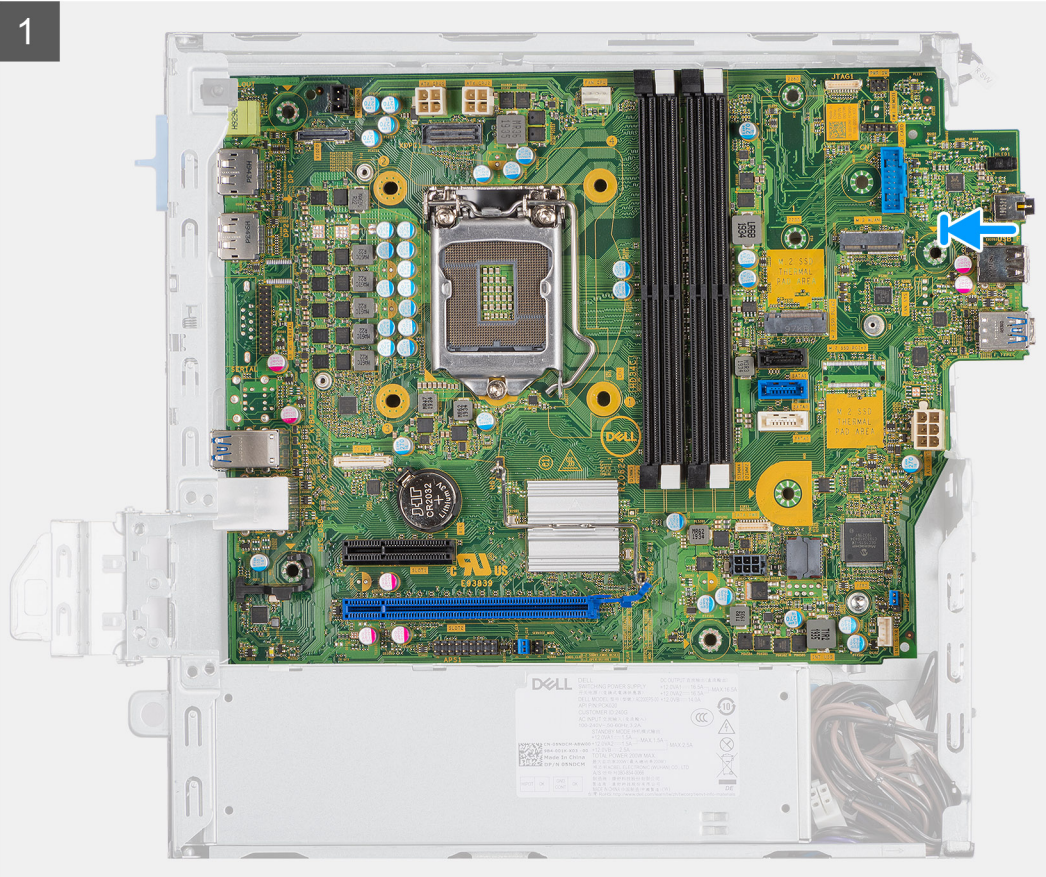
### 전제조건

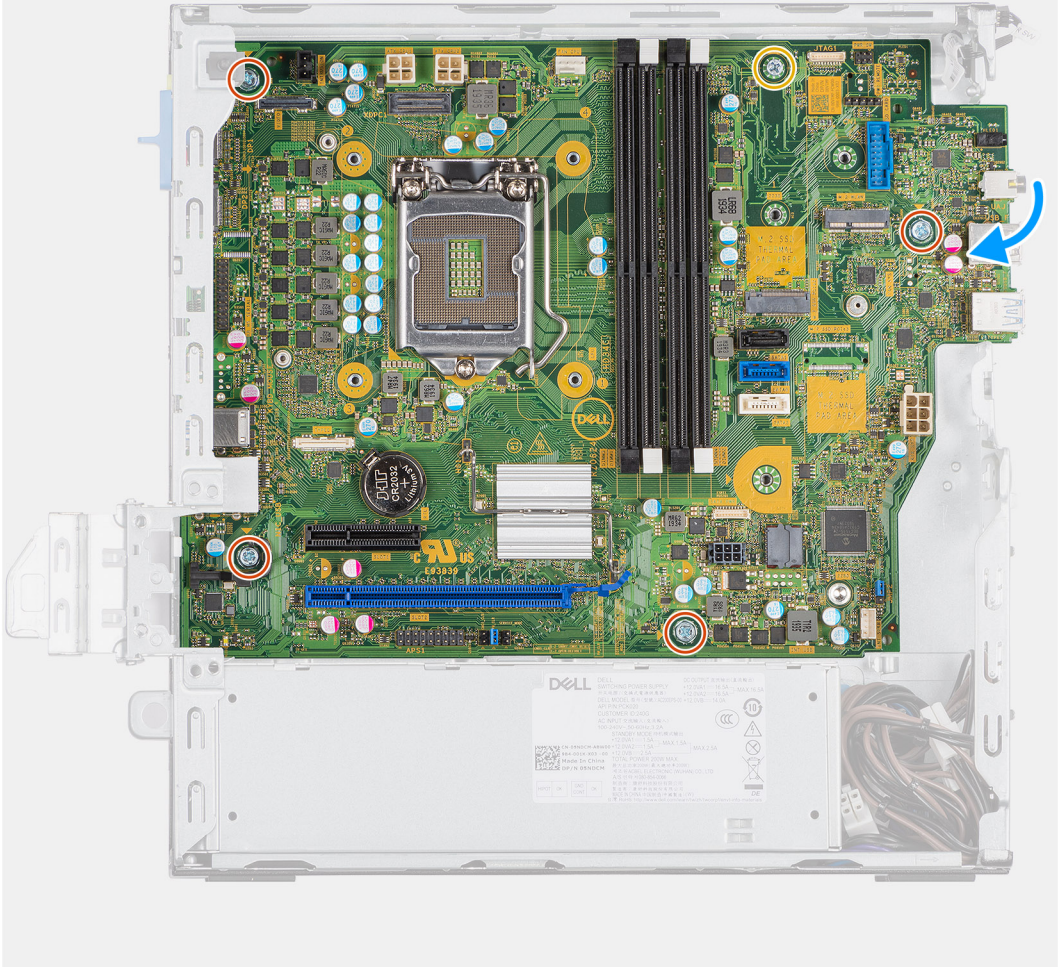
구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

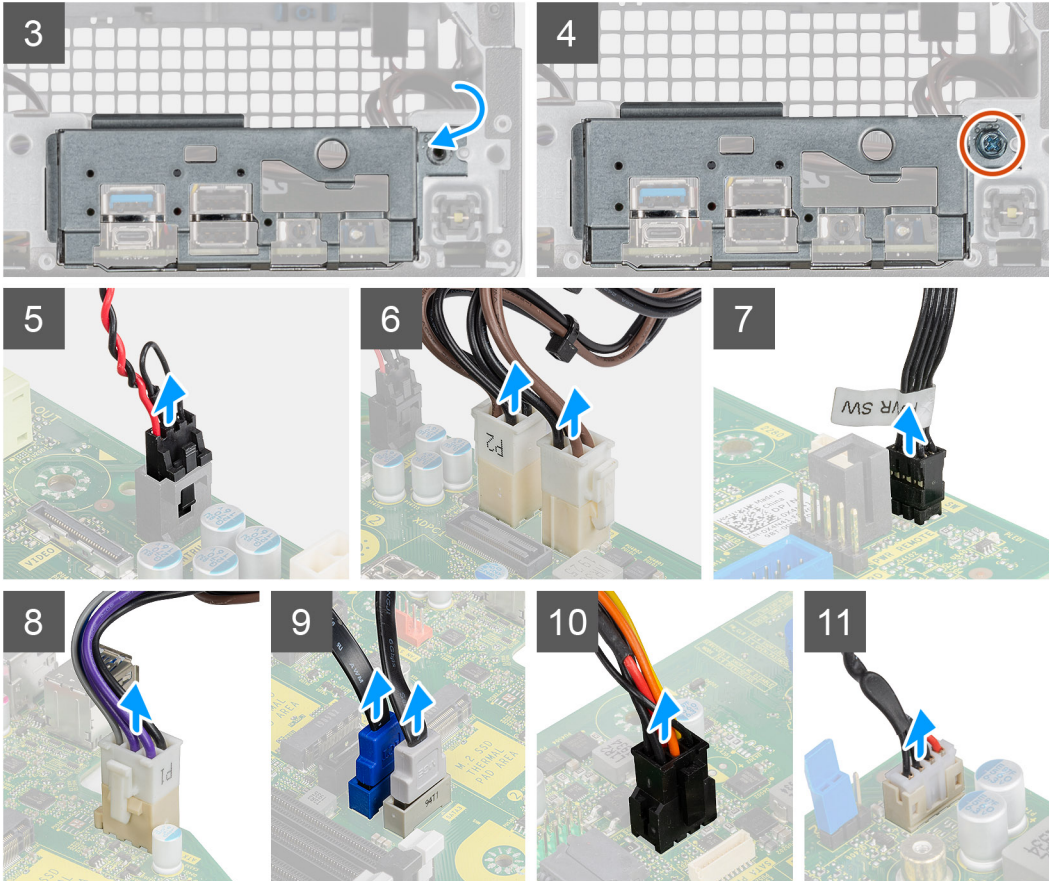
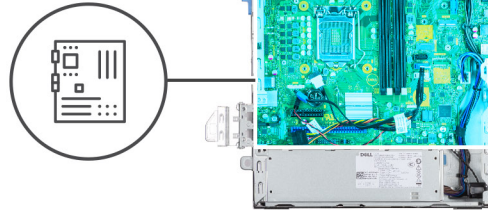
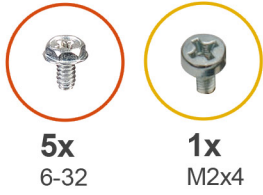
### 이 작업 정보

다음 그림은 시스템 보드의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.

1







### 단계

1. 시스템 보드 후면의 커넥터가 새시의 슬롯에 맞춰지고 시스템 보드의 나사 구멍이 시스템의 격리 애자에 맞춰질 때까지 시스템 보드를 시스템 안으로 맞춰 내립니다.
2. 4개의 나사(6-32)와 1개의 격리 애자 나사(M2x4)를 장착하여 시스템 보드를 새시에 고정합니다.
3. I/O 패널을 새시의 슬롯에 맞춰 안으로 내립니다.
4. 6-32 나사를 장착하여 I/O 패널을 새시에 고정합니다.
5. 침입 스위치 케이블을 다시 연결합니다.
6. 시스템 보드 전원 공급 장치 케이블을 다시 연결합니다.
7. 전원 버튼 스위치 케이블을 다시 연결합니다.
8. 시스템 팬 케이블을 다시 연결합니다.
9. 프로세서 전원 공급 장치 케이블을 다시 연결합니다.
10. SATA 케이블을 다시 연결합니다.
11. SATA 전원 케이블을 다시 연결합니다.
12. 내부 스피커 케이블을 다시 연결합니다.

### 다음 단계

1. 프로세서를 설치합니다.
2. 메모리 모듈을 설치합니다.

3. 방열판을 설치합니다.
4. WLAN 카드를 설치합니다.
5. 솔리드 스테이트 드라이브를 설치합니다.
6. 하드 드라이브 어셈블리를 설치합니다.
7. 전면 베젤을 설치합니다.
8. 측면 커버를 설치합니다.
9. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

## 문제 해결

### 주제:

- Dell SupportAssist 사전 부팅 시스템 성능 검사 진단
- 진단
- 진단 오류 메시지
- 시스템 오류 메시지
- Wi-Fi 전원 주기

## Dell SupportAssist 사전 부팅 시스템 성능 검사 진단

### 이 작업 정보

SupportAssist 진단(시스템 진단이라고도 함) 프로그램은 하드웨어 전체 검사를 수행합니다. Dell SupportAssist 사전 부팅 시스템 성능 검사 진단 진단은 BIOS에 내장되어 있으며 BIOS에 의해 내부적으로 시작됩니다. 내장형 시스템 진단 프로그램은 특정 디바이스 그룹 또는 디바이스에 대해 일련의 옵션을 제공하여 사용자가 다음을 수행할 수 있게 합니다.

- 자동으로 테스트 또는 상호 작용 모드를 실행합니다.
- 테스트를 반복합니다.
- 테스트 결과를 표시 또는 저장합니다.
- 오류가 발생한 디바이스에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 추가 테스트 옵션으로 세부 검사를 실행합니다.
- 테스트가 성공적으로 완료되었음을 알리는 상태 메시지를 봅니다.
- 테스트 중 발생하는 문제를 알리는 오류 메시지를 봅니다.

**① 노트:** 특정 디바이스를 위한 일부 테스트는 사용자 상호 작용을 요구합니다. 진단 테스트를 수행할 때는 항상 컴퓨터 터미널 앞을 지켜야 합니다.

자세한 정보는 [내장형 및 온라인 진단으로 하드웨어 문제 해결\(SupportAssist ePSA, ePSA 또는 PSA 오류 코드\)](#)을 참조하십시오.

## SupportAssist 사전 부팅 시스템 성능 검사 실행

### 단계

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 컴퓨터가 부팅될 때 Dell 로고가 나타나면 F12 키를 누릅니다.
3. 부팅 메뉴 화면에서 **Diagnostics(진단)** 옵션을 선택합니다.
4. 왼쪽 하단의 화살표를 클릭합니다.  
진단 전면 페이지가 표시됩니다.
5. 오른쪽 하단 모서리의 화살표를 클릭하여 페이지 목록으로 이동합니다.  
감지된 항목이 나열됩니다.
6. 특정 디바이스에서만 진단 테스트를 실행하려면 Esc를 누른 다음 **Yes(예)**를 눌러 진단 테스트를 중지합니다.
7. 왼쪽 창에서 장치를 선택하고 **Run Tests(테스트 실행)**을 클릭합니다.
8. 문제가 발생하면 오류 코드가 표시됩니다.  
오류 코드와 검증 번호를 메모해둔 후 Dell에 문의하십시오.

## 진단

컴퓨터 POST(Power On Self Test)는 부팅 프로세스가 시작되기 전에 기본 컴퓨터 요구 사항을 만족시키고 하드웨어가 적절하게 작동하도록 합니다. 컴퓨터가 POST를 통과하면 컴퓨터가 계속 정상 모드로 시작됩니다. 그러나 컴퓨터가 POST를 통과하지 못하면 시동 중에 일련의 LED 코드를 내보냅니다. 시스템 LED는 전원 버튼에 내장되어 있습니다.

다음 표에서 표시등의 다양한 패턴과 의미를 설명합니다.

표 7. 진단 LED 동작

깜박임 패턴		문제 설명
주황색	흰색	
1	2	복구할 수 없는 SPI 플래시 장애
2	1	CPU 오류
2	2	시스템 보드 장애(BIOS 손상 또는 ROM 오류 등)
2	3	메모리/RAM이 발견되지 않음
2	4	메모리/RAM 장애
2	5	잘못된 메모리 설치
2	6	시스템 보드/칩셋 오류/클럭 장애/게이트 A20 장애/슈퍼 I/O 장애/키보드 컨트롤러 장애
3	1	CMOS 배터리 오류
3	2	PCI 또는 비디오 카드/칩 장애
3	3	BIOS 복구 이미지를 찾을 수 없음
3	4	BIOS 복구 이미지를 찾았지만 유효하지 않음
3	5	전원 레일 장애
3	6	SBIOS 플래시 손상
3	7	인텔 ME(Management Engine) 오류
4	2	CPU 전원 케이블 연결 문제

## 진단 오류 메시지

표 8. 진단 오류 메시지

오류 메시지	설명
AUXILIARY DEVICE FAILURE	터치패드 또는 외장형 마우스에 결함이 있을 수 있습니다. 외장형 마우스의 경우 케이블 연결을 점검하십시오. 시스템 설치 프로그램에서 <b>Pointing Device(지정 장치)</b> 옵션을 활성화하십시오.
BAD COMMAND OR FILE NAME	명령을 올바르게 입력했는지, 정확한 위치에 띄어쓰기를 했는지, 올바른 경로명을 입력했는지 확인하십시오.
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE	마이크로프로세서 내부의 주 캐시에 오류가 발생했습니다. <b>Dell 에 문의하기</b>
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE	광학 드라이브가 컴퓨터의 명령에 응답하지 않습니다.
DATA ERROR	하드 드라이브가 데이터를 읽을 수 없습니다.
DECREASING AVAILABLE MEMORY	하나 이상의 메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니다. 메모리 모듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.
DISK C: FAILED INITIALIZATION	하드 드라이브를 초기화하지 못했습니다. <b>Dell Diagnostics</b> 에서 하드 드라이브 테스트를 실행하십시오.
DRIVE NOT READY	이 작업을 계속하려면 하드 드라이브가 베이에 존재해야 합니다. 하드 드라이브 베이에 하드 드라이브를 설치하십시오.

표 8. 진단 오류 메시지 (계속)

오류 메시지	설명
ERROR READING PCMCIA CARD	컴퓨터가 ExpressCard를 식별할 수 없습니다. 카드를 다시 삽입하거나 다른 카드를 넣어보십시오.
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED	NVRAM에 기록되어 있는 메모리량이 컴퓨터에 설치된 메모리 모듈과 일치하지 않습니다. 컴퓨터를 재시작하십시오. 오류가 계속 나타나면 <b>Dell사</b> 에 문의하십시오.
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE	복사하려는 파일 용량이 디스크에 비해 너무 크거나 디스크가 꽉 차 있습니다. 다른 디스크에 복사하거나 용량이 더 큰 디스크를 사용하십시오.
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < >   -	파일 이름에 다른 문자를 사용하십시오.
GATE A20 FAILURE	메모리 모듈이 느슨해졌을 수 있습니다. 메모리 모듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.
GENERAL FAILURE	운영 체제가 명령을 실행할 수 없습니다. 이 메시지는 일반적으로 특정 정보와 함께 표시됩니다. 예를 들어, Printer out of paper. Take the appropriate action.
HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR	컴퓨터가 드라이브 유형을 식별할 수 없습니다. 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 분리한 다음, 광학 드라이브로 컴퓨터를 부팅합니다. 그런 다음, 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 재설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. <b>Dell Diagnostics</b> 에서 <b>Hard Disk Drive(하드 디스크 드라이브)</b> 테스트를 실행하십시오.
HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0	하드 드라이브가 컴퓨터의 명령에 응답하지 않습니다. 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 분리한 다음, 광학 드라이브로 컴퓨터를 부팅합니다. 그런 다음, 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 재설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 문제가 지속된다면 다른 드라이브를 사용해보십시오. <b>Dell Diagnostics</b> 에서 <b>Hard Disk Drive(하드 디스크 드라이브)</b> 테스트를 실행하십시오.
HARD-DISK DRIVE FAILURE	하드 드라이브가 컴퓨터의 명령에 응답하지 않습니다. 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 분리한 다음, 광학 드라이브로 컴퓨터를 부팅합니다. 그런 다음, 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 재설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 문제가 지속된다면 다른 드라이브를 사용해보십시오. <b>Dell Diagnostics</b> 에서 <b>Hard Disk Drive(하드 디스크 드라이브)</b> 테스트를 실행하십시오.
HARD-DISK DRIVE READ FAILURE	하드 드라이브에 결함이 존재할 수 있습니다. 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 분리한 다음, 광학 드라이브로 컴퓨터를 부팅합니다. 그런 다음, 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 재설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 문제가 지속된다면 다른 드라이브를 사용해보십시오. <b>Dell Diagnostics</b> 에서 <b>Hard Disk Drive(하드 디스크 드라이브)</b> 테스트를 실행하십시오.
INSERT BOOTABLE MEDIA	운영 체제에서 부팅 불가능한 미디어(예: 광학 드라이브)로 부팅하려고 합니다. 부팅 매체를 삽입하십시오.
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM	시스템 구성 정보가 하드웨어 구성과 일치하지 않습니다. 이 메시지는 메모리 모듈을 설치한 후에 나타날 가능성이 가장 높습니다. 시스템 설치 프로그램의 해당 옵션을 수정하십시오.
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE	외장형 키보드의 경우, 케이블 연결을 확인하십시오. <b>Dell Diagnostics</b> 에서 <b>Keyboard Controller(키보드 컨트롤러)</b> 테스트를 실행하십시오.
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE	외장형 키보드의 경우, 케이블 연결을 확인하십시오. 컴퓨터를 재시작하고 부팅 루틴 동안에 키보드나 마우스를 건드리지 마십시오. <b>Dell Diagnostics</b> 에서 <b>Keyboard Controller(키보드 컨트롤러)</b> 테스트를 실행하십시오.

표 8. 진단 오류 메시지 (계속)

오류 메시지	설명
KEYBOARD DATA LINE FAILURE	외장형 키보드의 경우, 케이블 연결을 확인하십시오. <b>Dell Diagnostics</b> 에서 <b>Keyboard Controller(키보드 컨트롤러)</b> 테스트를 실행하십시오.
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE	외장형 키보드 또는 키패드의 경우 케이블 연결을 확인하십시오. 컴퓨터를 재시작하고 부팅 루틴 동안에 키보드나 키를 건드리지 마십시오. <b>Dell Diagnostics</b> 에서 <b>Stuck Key(스턱 키)</b> 테스트를 실행하십시오.
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT	Dell MediaDirect에서 파일의 DRM(Digital Rights Management) 제한을 확인할 수 없으므로 파일을 재생할 수 없습니다.
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니다. 메모리 모듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.
MEMORY ALLOCATION ERROR	실행하려는 소프트웨어가 운영체제, 다른 프로그램 또는 유틸리티와 충돌합니다. 컴퓨터를 종료하고 30초 정도 기다린 다음 컴퓨터를 재시작하십시오. 프로그램을 다시 실행하십시오. 오류 메시지가 여전히 나타나면, 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니다. 메모리 모듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니다. 메모리 모듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니다. 메모리 모듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.
NO BOOT DEVICE AVAILABLE	컴퓨터가 하드 드라이브를 찾을 수 없습니다. 하드 드라이브가 부팅 장치인 경우 드라이브가 정확하게 설치 및 장착되고, 부팅 장치로 사용할 수 있도록 파티션이 나뉘었는지 확인하십시오.
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE	운영 체제가 손상되었을 수 있습니다. <b>Dell</b> 에 문의하십시오.
NO TIMER TICK INTERRUPT	시스템 보드의 칩에서 오동작이 발생했을 수 있습니다. <b>Dell Diagnostics</b> 에서 <b>System Set(시스템 설정)</b> 테스트를 실행하십시오.
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN	프로그램이 너무 많이 열려 있습니다. 모든 창을 닫고 사용할 프로그램을 여십시오.
OPERATING SYSTEM NOT FOUND	운영 체제를 다시 설치합니다. 문제가 지속되면 <b>Dell</b> 사에 문의하십시오.
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM	선택 사양인 ROM에 오류가 발생했습니다. <b>Dell</b> 사에 문의하십시오.
SECTOR NOT FOUND	운영 체제가 하드 드라이브에서 섹터를 찾을 수 없습니다. 하드 드라이브의 섹터에 결함이 있거나 FAT(파일 할당표)이 손상되어 있을 수 있습니다. Windows 오류 검사 유틸리티를 실행하여 하드 드라이브의 파일 구조를 검사하십시오. 지침은 <b>Windows 도움말 및 지원</b> 을 참조하십시오( <b>시작 &gt; 도움말 및 지원</b> 클릭). 많은 섹터에 결함이 있으면 데이터를 백업(가능한 경우)하고, 하드 드라이브를 포맷하십시오.
SEEK ERROR	운영체제가 하드 드라이브상의 특정 트랙을 찾을 수 없습니다.
SHUTDOWN FAILURE	시스템 보드의 칩에서 오동작이 발생했을 수 있습니다. <b>Dell Diagnostics</b> 에서 <b>System Set(시스템 설정)</b> 테스트를 실행하십시오. 메시지가 다시 나타나면 <b>Dell</b> 사에 문의하십시오.
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER	시스템 구성 설정이 손상되었습니다. 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하여 전지를 충전하십시오. 문제가 지속되면 시스템 설치 프로그램을 시작하여 데이터를 복원한 다음 즉시 프로그램을 종료합니다. 메시지가 다시 나타나면 <b>Dell</b> 사에 문의하십시오.

표 8. 진단 오류 메시지 (계속)

오류 메시지	설명
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED	시스템 구성을 지원하는 예비 전지가 재충전이 필요할 수 있습니다. 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하여 전지를 충전하십시오. 문제가 지속되면 <b>Dell사</b> 에 문의하십시오.
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM	시스템 설치 프로그램에 저장된 시간 또는 날짜가 시스템 클럭과 일치하지 않습니다. <b>날짜 및 시간</b> 옵션의 설정을 수정하십시오.
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED	시스템 보드의 칩에서 오동작이 발생했을 수 있습니다. <b>Dell Diagnostics</b> 에서 <b>System Set(시스템 설정)</b> 테스트를 실행하십시오.
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE	키보드 컨트롤러가 오작동하거나 메모리 모듈이 느슨하게 되었을 수 있습니다. <b>Dell Diagnostics</b> 에서 <b>System Memory(시스템 메모리)</b> 테스트와 <b>Keyboard Controller(키보드 컨트롤러)</b> 테스트를 실행하거나, <b>Dell사</b> 에 문의하십시오.
X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY	드라이브에 디스크를 삽입하고 다시 시도하십시오.

## 시스템 오류 메시지


표 9. 시스템 오류 메시지

시스템 메시지	설명
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support	컴퓨터가 3회 연속 동일한 오류 때문에 부팅 루틴을 완료하지 못했습니다.
CMOS checksum error	RTC가 재설정되었고 <b>BIOS 설정</b> 기본값이 로드되었습니다.
CPU fan failure	CPU 팬에 오류가 있습니다
System fan failure	시스템 팬에 오류가 있습니다
Hard-disk drive failure	POST 도중 하드 디스크 드라이브 오류가 발생했을 수 있습니다.
Keyboard failure	키보드에 장애가 발생했거나 케이블이 느슨합니다. 케이블을 다시 연결해도 문제가 해결되지 않으면 키보드를 교체합니다.
No boot device available	하드 디스크 드라이브의 부팅 가능 파티션이 없거나 하드 디스크 드라이브 케이블이 느슨하거나 부팅 가능한 장치가 존재하지 않습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 하드 드라이브가 부팅 장치인 경우, 케이블이 연결되어 있는지 확인하십시오. 드라이브는 올바르게 부팅 장치로 설치되고 파티션됩니다.</li> <li>• 시스템 설치 프로그램을 시작하여 부팅 순서 내용이 올바른지 확인하십시오.</li> </ul>
No timer tick interrupt	시스템 보드의 칩이 오작동하거나 마더보드 오류가 발생했을 수 있습니다.
NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem	S.M.A.R.T 오류. 하드 디스크 드라이브 오류일 수 있습니다.

# Wi-Fi 전원 주기

## 이 작업 정보

Wi-Fi 연결 문제로 인해 컴퓨터에서 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 Wi-Fi 전원 주기 절차를 수행할 수 있습니다. 다음 절차는 Wi-Fi 전원 주기를 수행하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

 **노트:** 일부 ISP(Internet Service Providers)는 모뎀/라우터 콤보 디바이스를 제공합니다.

## 단계

1. 컴퓨터를 끕니다.
2. 모뎀을 끕니다.
3. 무선 라우터를 끕니다.
4. 약 30초간 기다립니다.
5. 무선 라우터를 켭니다.
6. 모뎀을 켭니다.
7. 컴퓨터를 켭니다.


## 도움말 보기

### 주제:

- Dell에 문의하기

## Dell에 문의하기

### 전제조건

 **노트:** 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 구매 송장, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 확인할 수 있습니다.

### 이 작업 정보

Dell은 다양한 온라인 및 전화 기반 지원과 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면

### 단계

1. **Dell.com/support**로 이동합니다.
2. 지원 카테고리를 선택합니다.
3. 페이지 맨 아래에 있는 **국가/지역 선택** 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인합니다.
4. 필요에 따라 해당 서비스 또는 지원 링크를 선택합니다.